

股票简称:气派科技

股票代码:688216



气派科技
chippacking

气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co.,Ltd.

(深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂房 301-2)

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

(申报稿)

保荐机构(主承销商)



华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD

(贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号)

二〇二六年七月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关的法律、法规及规范性文件以简易程序向特定对象发行股票。本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2025 年年度股东会授权公司董事会实施，根据 2025 年年度股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 27 日第五届董事会第六次会议审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。公司于 2026 年 7 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案为：

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，公司将在经过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象共 8 名，分别为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。发行对象以现金方式认购本次以简易程序向特定对象发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2026 年 7 月 1 日）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 37.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。

2026 年 7 月 3 日，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 37.79 元/股。

（五）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次发行拟发行股票数量为 2,910,822 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准。本次发行的具体获配情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	诺德基金管理有限公司	1,270,177	47,999,988.83
2	张林	396,930	14,999,984.70
3	任续	396,930	14,999,984.70
4	财通基金管理有限公司	317,544	11,999,987.76

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)
5	董卫国	158,772	5,999,993.88
6	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号 私募证券投资基金	132,310	4,999,994.90
7	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号 私募证券投资基金	132,310	4,999,994.90
8	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私 募证券投资基金	105,849	4,000,033.71
合计		2,910,822	109,999,963.38

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整，调整公式为：

$$Q_1 = Q_0 \times (1 + n)$$

其中：Q₀为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q₁为调整后的本次发行股票数量。

（六）限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金数量及投向

本次发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

本次发行股票募集资金全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程

序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润安排

公司在本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（十）未来三年分红回报规划

为进一步健全和完善公司利润分配及现金分红有关事项，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司制定了《气派科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（十一）本次发行后填补被摊薄即期回报的措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“八、发行人董事会声明”。同时，公司提示投资者关注本募集说明书中公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请

广大投资者注意投资风险。

二、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）市场和行业风险

1、宏观经济及下游相关行业波动的风险

公司主营业务为半导体封装测试，半导体行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。半导体行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球半导体产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

同时，公司下游消费电子行业产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期短于其他传统行业。如果公司未来不能快速响应终端市场的需求变化，或公司主要客户对应产品在终端市场竞争中处于不利地位，公司现有市场规模将难以保持甚至出现萎缩，进而对公司经营业绩造成不利影响。

2、半导体行业周期性波动的风险

半导体行业具有较强的周期性，全球半导体行业在技术驱动和宏观经济的影响下呈周期性波动。报告期内，伴随着 5G 应用、物联网、消费电子、人工智能、大数据、自动驾驶、电动汽车等下游应用领域的普及和发展，半导体行业出现了一波上升周期。但与此同时，宏观经济波动、半导体下游行业产品生命周期变化、半导体产业技术升级、终端消费者消费习惯变化均可能导致半导体周期转换。

未来，若半导体行业出现周期性波动，或出现下游需求规模锐减等不利情形，半导体封装测试企业可能出现订单减少及盈利能力下降等问题，从而对公司的经营水平带来一定不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展

成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。但随着客户对半导体封装、测试的需求不断增长，一方面，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金增加生产线、进行技术和产品的升级改造以提升产品产能、质量和技术水平，还通过收购兼并的方式实现了产能的大幅提升和技术的升级迭代。另一方面，外资和合资封装测试企业进一步布局中国大陆，加大了资金和资源的投入。

因此，公司作为国内半导体封装测试第二梯队企业，相关产品不仅面临国内、国际同行业企业的激烈竞争，还面临行业潜在或新进入者的竞争威胁。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，将可能导致公司产品市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）财务风险

1、净利润持续为负的风险

报告期内，公司净利润分别为-13,099.99万元、-10,579.91万元、-8,178.64万元和-478.26万元，受到以消费电子为代表的下游行业需求变动的影响，报告期内公司业绩连续亏损，但亏损持续收窄。虽然本次向特定对象发行股票的募集资金预计将有利于改善公司经营和财务状况，但是公司仍然存在因行业持续低迷或经营不当导致净利润持续为负的风险。

2、毛利率波动风险

公司主要从事半导体封装测试业务，经营业绩及整体毛利率水平会随着终端产品市场的波动而出现较大变化。报告期内，公司主营业务收入分别为52,133.82万元、62,700.12万元、73,634.44万元和21,393.45万元，主营业务毛利率分别为-17.43%、-5.94%、2.44%和7.31%。

公司产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品生产难度、公司销售及市场策略、折旧摊销及材料和人力成本等因素综合影响而波动。未来若市场竞争进一步加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格，或行业终端需求不足，公司产能利用率

下降，折旧摊销及人力成本等固定支出对毛利率的影响放大，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

3、应收账款发生坏账风险

公司报告期各期末应收账款净额分别为10,971.03万元、12,082.10万元、15,511.96万元和14,852.40万元，占当期流动资产的比例分别为31.56%、29.56%、33.58%和30.64%，占比较高。报告期内，公司应收账款账龄整体较短，账龄1年以内应收账款占应收账款余额的比例均在95%以上；公司建立了相应的应收账款管理制度加强应收账款的回收管理，应收账款实际发生坏账的风险较小。

未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果客户经营情况恶化，出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、存货跌价损失的风险

报告期各期末，公司存货账面净额分别为10,309.70万元、11,860.88万元、13,484.59万元和14,814.21万元，占当期流动资产的比例分别为29.66%、29.02%、29.19%和30.57%，存货占流动资产的比例较高。尽管公司的生产模式主要为以销定产的定制化生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产；但公司报告期末存货余额较大，若下游客户存在重大延期或违约，公司将承担存货跌价的风险。

5、净资产收益率和每股收益被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报的风险，同时提示投资者，公司虽然为此制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

6、流动性风险

近年来，发行人投入大额资金投资建设小型先进集成电路（芯片）封装测试

生产线技术改造项目、二期厂房及先进集成电路封装测试项目的建设运营项目，导致有息负债余额大幅增加。截至 2026 年 3 月 31 日，公司短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债及长期应付款余额合计 50,830.52 万元。报告期各期末，公司流动比率分别为 0.43、0.44、0.46 和 0.57，速动比率分别为 0.30、0.31、0.33 和 0.39，资产负债率（合并）分别为 60.03%、65.86%、69.35%和 62.13%。公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标呈上升趋势，但较同行业可比公司偏低；资产负债率偏高，公司存在一定的流动性风险。如果未来公司封装测试产品销售情况不及预期，将会对公司盈利水平和公司现金流状况造成不利影响。如未来银行信贷政策发生不利变化、公司出现流动性管理不善等情形，将显著增加公司的偿债风险和流动性风险，并对公司生产经营造成不利影响。

（三）经营风险

1、生产效率下降风险

半导体封装测试行业的生产模式最主要的特点是多批次、多品种，如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出符合客户要求的产品，同时满足客户快速交货的需求是企业核心竞争力的重要体现。

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

2、核心技术人员流失的风险

公司自成立以来一直从事半导体封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着半导体封装测试市场竞争的不断加剧及新的参与者加入，企业之间对人才尤其是优秀研发技术人员的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现研发技术人员流失，公司还将

面临技术泄密的风险。

3、经营规模扩张带来的管理风险

随着公司总体经营规模进一步扩大，公司的资产规模、生产规模、销售规模等都将增加，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。公司通过多年的持续发展，已建立起与公司业务相匹配的经营管理体系，但如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，公司将存在一定的经营管理风险，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

4、技术风险

半导体封测技术需要紧跟市场需求，芯片设计、晶圆制造等领域的技术进步及下游对于小型化、低功耗器件持续增长的需求，对封测技术研发不断提出新要求。若公司未来的技术研发方向不能顺应市场封装技术的变化及不断提高的工艺标准，公司将面临无法持续满足下游领域对于产品技术升级的需求，技术研发压力较大，研发投入无法取得预期效果，对公司未来经营业绩将造成不利影响。

5、房屋及土地已抵押的风险

广东气派将其拥有的“东府国用（2014）第特 112 号”国有土地使用权 66,670.10 平方米及其上的全部房产（粤[2017]东莞不动产权第 0119369 号、粤[2017]东莞不动产权第 0119366 号等 9 项）抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（一押）和中国银行股份有限公司东莞分行（二押）。如果未来公司生产经营出现重大不利变化导致资金链断裂而造成贷款违约，公司将面临被债权人主张担保债权而导致该土地使用权及房产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险。

6、行政处罚风险

报告期内，公司及其子公司存在受到相关政府部门行政处罚的情形。公司及其子公司针对相应处罚情况迅速开展整改工作，并完善了行政处罚事项中涉及的相关制度，在日常经营过程中进一步加强监督管理，明确岗位责任制，确保制度的执行与落地。报告期内，相关主体受到主管部门行政处罚的行为不属于重大违法违规行为，相关行政处罚亦不属于重大行政处罚，对生产经营影响较小。但若相关管理制度在公司及其子公司日常经营管理中执行不到位，或是相关工作人员

在具体工作过程中没有严格执行公司相关制度要求,则公司及其子公司未来仍可能受到相关政府部门的行政处罚,对公司及其子公司的声誉和日常经营造成一定影响。

(四) 募投项目新增折旧摊销的风险

公司本次发行募集资金投资的“高密度高性能芯片封测项目”总投资规模为19,812.39万元,预计未来三年(2027年-2029年)新增折旧摊销517.96万元、1,107.41万元和1,501.66万元,新增折旧摊销金额可控,占预计募投项目新增主营业务收入比重分别为12.99%、11.90%、11.30%。该募投项目全部建成达产后,公司预计每年新增折旧摊销金额1,669.57万元。

若本次募投项目投产后市场环境发生重大不利变化、下游市场需求不足、公司生产经营发生重大不利变化等情况,或募投项目在投产后未能及时产生预期效益,公司将面临收入增长不能消化每年新增折旧及摊销费用的风险,并将对公司未来的经营业绩产生较大的不利影响。

(五) 募集资金使用效益未达预期的风险

本次募集资金投资项目是公司在对市场发展和行业技术趋势,以及公司自身发展战略和条件做出审慎分析基础上,做出的投资决策,公司对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证。如项目建成投入使用后,市场环境突变、行业竞争加剧、产业政策发生重大变化,相关产业不能保持同步协调发展,将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

(六) 审批和发行风险

本次股票发行方案已经公司董事会审议通过,尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定,能否获得相关审批机构的批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案.....	2
二、特别风险提示.....	6
目 录.....	12
释 义.....	15
一、一般术语.....	15
二、专业术语.....	16
第一节 发行人基本情况	19
一、发行人基本情况.....	19
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	20
三、公司所处行业的管理体制、主要特点及行业竞争情况.....	22
四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	39
五、公司现有业务发展安排及未来发展战略.....	56
六、报告期内公司的行政处罚情况.....	57
七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	59
八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施.....	62
九、上市以来的重大资产重组情况.....	63
十、境外经营情况.....	64
十一、规范运作情况.....	64
第二节 本次证券发行概要	66
一、本次发行的背景和目的.....	66
二、发行对象及与公司的关系.....	69
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	70
四、募集资金金额及投向.....	71
五、本次发行是否构成关联交易.....	71
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	71
七、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件.....	72

八、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件.....	72
九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	78
十、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”	79
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	80
一、本次募集资金使用计划.....	80
二、本次募集资金的必要性、可行性分析.....	80
三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	86
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目 实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	88
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	90
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	90
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	90
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际 控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	90
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际 控制人可能存在的关联交易的情况.....	90
五、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	91
第五节 与本次发行相关的风险因素	96
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的 因素.....	96
（一）市场和行业风险.....	96
（二）财务风险.....	96
二、审批与发行风险.....	98
第六节 与本次发行相关的声明	99
一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明.....	99
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	100
三、保荐机构（主承销商）声明.....	101
四、发行人律师声明.....	103
五、审计机构声明.....	104

六、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺.....105

七、发行人控股股东、实际控制人承诺.....106

八、发行人董事会声明.....107

附录..... 110

 一、专利.....110

释 义

本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、一般术语

气派科技/发行人/ 气派股份/股份公司 /公司/本公司	指	气派科技股份有限公司
气派有限/有限公司	指	深圳市气派科技有限公司
广东气派	指	广东气派科技有限公司
气派谋远	指	东莞市气派谋远股权投资合伙企业（有限合伙）
香港气派	指	气派科技（香港）有限公司
气派芯竞	指	气派芯竞科技有限公司
芯源集成	指	东莞市芯源集成电路科技发展有限公司
惠州气派	指	惠州气派科技有限公司
本次发行	指	公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所科创板上市的行为
股东会	指	气派科技股份有限公司股东会
董事会	指	气派科技股份有限公司董事会
审计委员会	指	气派科技股份有限公司董事会审计委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行的公司章程
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委、发改 委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司，为主板上市公司，股票简称为上海贝岭，股票代码为 600171
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司，为主板上市公司，股票简称兆易创新，股票代码为 603986
晟矽微电	指	上海晟矽微电子股份有限公司，为新三板挂牌公司，股票简称为晟矽微电，股票代码为 430276
英集芯	指	深圳英集芯科技股份有限公司，为科创板上市公司，股票简称为英集芯，股票代码为 688209

钰太科技	指	钰太科技股份有限公司，为中国台湾上市公司，股票简称为钰太科技，股票代码 6679
天钰科技	指	天钰科技股份有限公司，为中国台湾上市公司，股票简称为天钰，股票代码 4961
矽力杰	指	矽力杰股份有限公司，为中国台湾上市公司，股票简称为矽力，股票代码 6415
芯迈半导体	指	芯迈半导体技术（杭州）股份有限公司，为中国香港上市公司，股票简称为芯迈半导体，股票代码 02240
蕊源科技	指	成都蕊源半导体科技股份有限公司
博威公司	指	河北博威集成电路有限公司
普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司，为科创板上市公司，股票简称普冉股份，股票代码为 688766
保荐机构/主承销商/华创证券	指	华创证券有限责任公司
审计机构/会计师/天职/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/天元	指	北京市天元律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
PCS/只/颗/片	指	公司产品数量的计量单位
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日

二、专业术语

集成电路/芯片/IC	指	按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构
功率半导体	指	支持高电压、大电流转换的半导体器件，可完成电子装置中电压和频率、直流交流的转换
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，指硅衬底的且在上面重复排布具有完整电性能的集成电路或者晶体管的晶圆，尺寸有 4 吋、5 吋、6 吋、8 吋、12 吋等
封装	指	对通过测试的晶圆进行减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。保护电路芯片免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起到保护芯片、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以连接芯片内部与外部电路的作用
先进封装	指	将工艺相对复杂、封装形式、封装技术、封装产品所用材料处于行业前沿的封装形式划分为先进封装
传统封装	指	将工艺相对简单、封装形式、封装技术、封装产品所用材料较为成熟的封装形式划分为传统封装，目前国内传统封装包括 SOP、SOT、DIP 等封装形式以及气派科技自主定义的 Qipai、CPC
SGS	指	通标标准技术服务有限公司

Qipai	指	由气派科技自主定义的双排直插式的封装形式
CPC	指	由气派科技自主定义的表面贴片式封装形式
DIP	指	Dual in line-pin package 的缩写，也叫双列直插式封装技术，采用双列直插形式封装的集成电路
SOP	指	Small Outline Package 的缩写，小外形封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
TSOP	指	Thin Small Outline Package 的缩写，意思是薄型小尺寸封装。TSOP 内存是在芯片的周围做出引脚，采用 SMT 技术（表面贴装技术）直接贴装在 PCB 板的表面
TSSOP	指	Thin Shrink Small Outline Package 的缩写，是薄型小的 SOP 封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
SOT	指	Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，随着集成电路集成度的提高，现在多用于封装集成电路，是表面贴装型封装之一，一般引脚小于等于 8 个的小外形晶体管、集成电路
LQFP	指	Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边引线扁平封装，塑封体厚度为 1.4mm
QFN	指	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低
DFN	指	Dual Flat No-lead Package 的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN 的设计和应用与 QFN 类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周
Flip Chip/FC	指	倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
TSV	指	Through Silicon Via 的缩写，硅通孔技术，是一种晶圆级堆叠高密度封装技术
BGA	指	Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装技术，它是集成电路采用有机载板的一种封装法
CDFN /CQFN	指	由气派科技自主创新且定义的封装系列，区别 SOP 和 QFN/DFN，在保证散热的情况下，既能使用回流焊焊接，也可以波峰焊焊接，是小体积的贴片式系列封装形式
LED	指	Lighting Emitting Diode 的缩写，发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件
IDF	指	Inter Digit Frame 的缩写，即相邻产品外引线脚交叉排列
氮化镓/GaN	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体材料，具有高击穿电压、高电流密度、电子饱和漂移速度高等特点，主要应用在 5G 通讯、半导体显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域
MIMO	指	Multiple Input Multiple Output 的缩写，指多通道输入输出技术，为极大地提高信道容量，在发送端和接收端都使用多根天线，在收发之间构成多个信道的天线系统
功放	指	功率放大器

Bumping	指	晶圆凸块封装技术，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电性能互连的“点”接口，反映了先进制程以“点替代线”的发展趋势，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，为印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电性能连接的载体
MCU	指	Microcontroller Unit 的缩写，微控制单元或单片微型计算机，是把中央处理器（CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（RAM 和 ROM）、定时计数器和多种 I/O（输入/输出）接口等集成在单一芯片上，形成芯片级的计算机
SiP	指	System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统
LGA	指	Land Grid Array 的缩写，触点阵列封装
WLP	指	Wafer Level Package 的缩写，晶圆级封装，在晶圆上进行大多数或者全部的封装工艺，之后再进行切割制成单个集成电路
CSP	指	Chip Scale Package 的缩写，指芯片级尺寸封装
MCM	指	Multi-Chip Module 的缩写，多芯片组件，将多个芯片组装在布线的 PCB 板上，然后进行封装
MCP	指	Multi-Chip Package 的缩写，多芯片封装，将多个芯片封装在一个封装体内
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写，晶圆片级芯片规模封装，此技术是先在整片晶圆上进行封装和测试，然后才切割成一个个的 IC 颗粒，封装后的体积约等同 IC 芯片的原尺寸
Fan-Out	指	扇出型封装，是基于晶圆的重构技术
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源、微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统
TO	指	Transistor Out-line Package 的缩写，即晶体管外形封装，是一种直插式的封装形式
PDFN	指	Power Dual Flat No-lead, 紧凑型表面贴装器件封装，采用塑封封装材料，无引脚设计，具有两面金属连接区域，适用于高密度集成电路

注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	气派科技股份有限公司
英文名称	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
法定代表人	梁大钟
公司设立日期	2006 年 11 月 7 日
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂房 301-2
办公地址	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
邮政编码	523330
公司网址	www.chippacking.com
联系电话	0769-89886666
联系传真	0769-89886013
公司电子邮箱	IR@chippacking.com
股票代码	688216
股票简称	气派科技
股本总额	114,404,321 元
经营范围	集成电路的研发、测试封装、设计、销售（不含蚀刻等有工业废水产生的工艺及其他限制项目），货物进出口、技术进出口；设备租赁（不含融资租赁）（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
统一信用代码	914403007954196722
上市日期	2021 年 6 月 23 日
股票上市地	上海证券交易所

注：上表中总股本为截至本募集说明书出具日最新数据，与 2026 年 3 月末股份总数的差异系公司对 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票实施回购注销所致。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）本次发行前公司的股权结构

截至 2026 年 3 月 31 日，公司股本结构如下表所示：

项目	股份数额（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	8,494,000	7.40%
1、国家持股	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%
3、其他内资持股	8,494,000	7.40%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%
境内自然人持股	8,494,000	7.40%
二、无限售条件股份	106,285,805	92.60%
1、人民币普通股	106,285,805	92.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%
4、其他	0	0.00%
三、股份总数	114,779,805	100.00%

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十名股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	梁大钟	境内自然人	46,190,000	40.24%	400,000
2	白瑛	境内自然人	12,000,000	10.45%	1,200,000
3	梁华特	境内自然人	6,300,000	5.49%	6,300,000
4	信达证券-平安银行-信达证券聚合 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	5,343,900	4.66%	0
5	施保球	境内自然人	1,079,800	0.94%	0
6	林新	境内自然人	960,616	0.84%	0
7	气派科技股份有限公司-2023 年员工持股计划	境内非国有法人	868,818	0.76%	0
8	虞玉明	境内自然人	845,194	0.74%	0

9	黄春霖	境内自然人	831,113	0.72%	0
10	中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	774,590	0.67%	0

注：梁大钟担任公司董事长、总经理，白瑛担任公司董事，二人持股遵守每年减少不超过其持有股份数量 25%的规定限制。

（二）发行人的控股股东、实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人

截至本募集说明书出具日，公司股本总额为 11,440.43 万股，梁大钟直接持有公司 4,619.00 万股股份，占公司总股本的 40.37%，系公司的控股股东，梁大钟通过气派谋远间接控制公司 1.50 万股，白瑛直接持有公司 1,200.00 万股，占公司股份总数的 10.49%，梁华特直接持有公司 630.00 万股，占公司股份总数的 5.51%。梁大钟、白瑛、梁华特直接持有公司 56.37%的股权，系公司的共同实际控制人。

梁瑶飞女士、梁晓英女士为实际控制人的一致行动人，分别直接持有公司股份 5.00 万股、16.00 万股。实际控制人及其一致行动人合计控制公司股份 6,471.50 万股，占公司总股本的 56.57%。

2、实际控制人基本情况

梁大钟先生基本情况如下：

梁大钟，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：33060219590205****。1959 年出生，本科，毕业于电子科技大学固体器件专业。1984 年 8 月至 1990 年 3 月任华越微电子有限公司工程师；1990 年 3 月至 1997 年 11 月在深圳电子市场从事业务工作；1997 年 11 月至 2008 年 11 月任深圳市天光微电子有限公司执行董事、总经理；2001 年 4 月至 2012 年 12 月任天光集成执行董事、总经理；2006 年 11 月至 2013 年 6 月任气派有限执行董事、总经理；2013 年 6 月至今任公司董事长、总经理；2013 年 5 月至 2022 年 9 月任广东气派执行董事、总经理；2022 年 9 月至 2024 年 7 月任广东气派执行董事；2022 年 4 月至今任东莞市芯源集成电路科技发展有限公司董事；2022 年 6 月至 2024 年 5 月任气派芯竞执行董事、总经理；2024 年 5 月至今任气派芯竞董事；2024 年 7 月至今任广东气派执行董

事、总经理；2025年1月至今任惠州气派执行董事、经理。

白瑛女士基本情况如下：

白瑛，女，中国国籍，无境外居留权，身份证号：33060219640529****。1964年生，高中。1983年9月至1992年5月就职于华越微电子有限公司；1992年6月至1997年11月在深圳电子市场从事业务工作；1997年11月至2008年11月任深圳市天光微电子有限公司副总经理，2001年4月至2012年12月任天光集成监事；2006年11月至2013年6月任气派有限监事；2013年6月至今任公司董事，2022年8月至今任气派科技（香港）有限公司董事。

梁华特先生基本情况如下：

梁华特，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号：44030419910524****。1991年生，本科，毕业于俄勒冈州立大学工商管理专业。2019年8月至2021年12月任上海榭客蟹餐饮管理有限公司合伙人；2022年1月至2023年8月任中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司设备工程师；2024年2月至2025年7月在公司封装制造中心任职；2024年5月至今任气派芯竞董事；2025年7月至今任公司总经理助理。

3、控股股东及实际控制人所持公司股份质押、冻结及权属纠纷的情况

截至2026年3月31日，控股股东、实际控制人所持公司股票不存在被质押、冻结的情况，也不存在权属纠纷。

三、公司所处行业的管理体制、主要特点及行业竞争情况

（一）发行人所处行业概述

公司主营业务为半导体封装测试业务，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路制造。

(二) 行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化。

公司所处行业的自律组织主要为中国半导体行业协会，主要负责贯彻落实政府半导体相关产业政策、开展产业及市场研究并向会员单位和政府主管部门提供咨询服务、行业自律管理以及代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

半导体行业内企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业主要的法律、法规

半导体行业是国民经济支柱性行业之一，是信息技术产业的重要组成部分，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。为推动我国以集成电路为主的半导体产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，近年来，国家相关部委及各级政府出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，促进半导体产业的快速发展。主要包括：

序号	文件名	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	全国人大	2026 年 3 月	加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
2	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	工信部、市场监督管理总局	2025 年 8 月	通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新

序号	文件名	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
3	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发 改委	2023 年 12 月	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试
4	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》	国务院	2022 年 12 月	壮大战略性新兴产业。深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用
5	《2022 年政府工作报告》	国务院	2022 年 3 月	推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	第十三届 全国人大 第四次会 议	2021 年 3 月	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展
7	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	2020 年 8 月	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施
8	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	财政部、 税务总 局、发 改委、 工信 部	2020 年 12 月	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税

3、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

公司主营的半导体封装测试作为半导体产业链的重要部分，行业内主要法律法规、发展规划、产业政策的发布和落实，为半导体产业的发展创造了良好的政策环境，为半导体行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，推动了半导体产业在近年来的快速发展，为公司创造了良好的经营环境，对公司的经营发展带来积极影响。

（三）行业发展趋势

1、行业概况

（1）半导体行业基本情况

半导体是现代电子信息产业的核心基础，其广泛应用于通信、计算、消费电子、汽车、工业控制等多个领域。随着人工智能、5G、物联网和新能源等新兴技术的快速发展，全球半导体市场保持高景气度，技术迭代加速，产品结构向高性能、低功耗和高集成度方向演进。产业链主要包括 IC 设计、晶圆制造、封装测试及配套的设备与材料环节，其中封装测试在连接前道制造与终端应用之间发挥关键桥梁作用，正逐步从传统功能延伸至系统性能优化与集成创新的前沿阵地。

近年来，中国政府高度重视半导体产业发展，将其列为战略性新兴产业予以重点扶持，推动本土企业在各细分环节加快布局，提升自主可控能力。目前，全球晶圆制造能力高度集中在台积电、三星、英特尔等领先企业手中，而封装测试环节则呈现出向中国大陆及东南亚集中的趋势。面对地缘政治风险与技术封锁压力，国内半导体产业正加速实现高端技术突破与产业链本地化，整体进入以创新驱动和生态构建为导向的发展新阶段。

（2）封装测试行业基本情况

半导体封装测试包括封装和测试两个环节，因测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业。

该环节主要承担晶圆切割后的芯片级封装、电气连接、机械支撑与功能验证等任务，是保障芯片可靠性和可用性的必要工序。封装形式涵盖多种尺寸与引脚类型，适配不同功能和封装密度需求。随着自动化设备普及与工艺标准化，封装

测试已具备较强的批量制造能力，企业间差异更多体现于封装结构设计能力、工艺整合效率及良率控制水平。

从行业结构看，封装测试属于半导体产业链中资本投入相对适中的环节，但对管理精细化与制程稳定性要求高，具有一定规模经济特征。中小企业在特定封装种类或定制化服务方面具有灵活性优势，而大型企业则通过扩产与技术积累形成产业协同与客户粘性。近年来，受益于下游市场对芯片多样化、小型化、稳定性的需求提升，封装测试行业呈现持续扩张态势，技术也在可靠性、热性能与集成度等维度不断演进，成为支持芯片规模化落地的重要制造支撑平台。

2、行业发展现状

（1）半导体行业市场

①全球半导体市场

2023 年，在全球经济增速放缓、电子产品消费低迷的背景下，全球半导体市场进入负增长区间，行业周期逐步探底后初现回暖迹象。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计,2023 年全球半导体市场规模从 2022 年创历史新高的 5,741 亿美元下降 8.22%,至 5,269 亿美元;2024 年全球半导体市场规模同比增长 19.67%,至 6,305 亿美元。2025 年全球半导体市场规模同比增长 26.18%，至 7,956 亿美元，创下历史最高的年销售额，2026 年市场规模预计将继续增长。

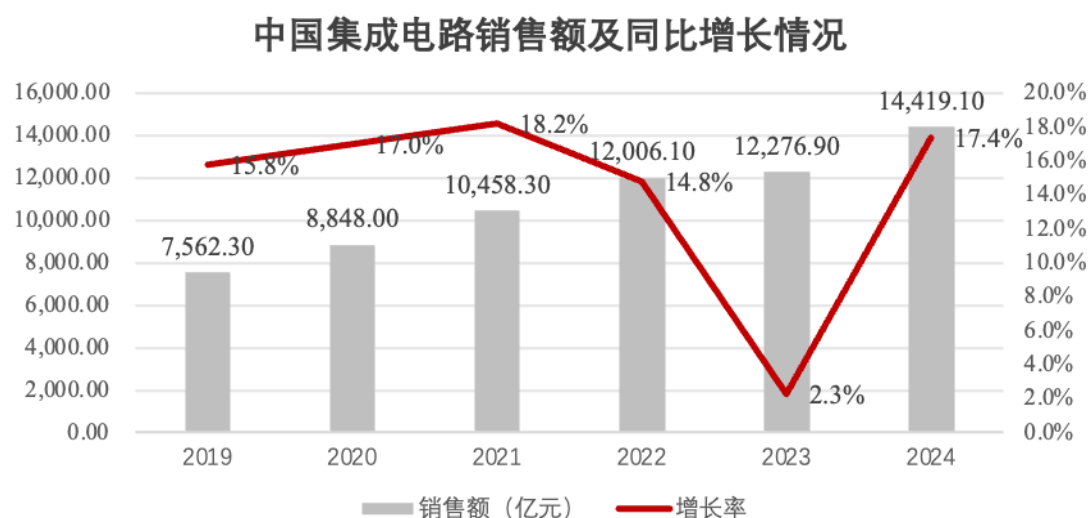


数据来源：WSTS

从半导体产业链分布变化来看，早期的半导体企业大多为垂直整合型 IDM 模式，即企业内部可完成设计、制造、封装测试等所有半导体生产环节，但这种模式下的企业普遍具有资产投入重、资金需求量大、变通不畅等缺点。20 世纪 90 年代，随着全球化进程加快和半导体制程难度的不断提高等原因，半导体产业链开始向专业化的分工方向发展，逐渐形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造企业和封装测试企业。自 21 世纪以来，受先进制程研发费用大幅提升、制程更新迭代速度加快以及大规模晶圆厂和封装厂投资总额大幅提高等因素的影响，众多 IDM 厂商纷纷缩减了晶圆产线和封装厂的投入。目前，半导体设计、晶圆制造和封装测试各自独立且垂直分工的产业模式，已成为半导体产业链中最普遍的经营模式。

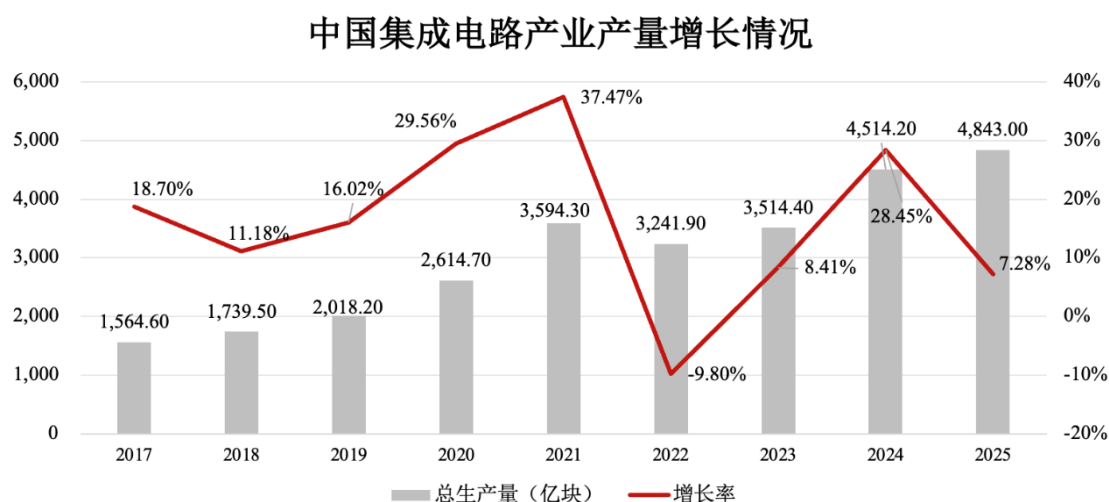
②中国半导体市场

从市场规模来看，相比全球市场而言，我国的半导体产业起步较晚，但在国家政策的大力支持下，发展速度明显快于全球水平。根据中国半导体行业协会统计，2019-2024 年，中国集成电路产业展现出强大发展韧性，产业规模整体呈上升态势，复合增长率达 13.8%。2024 年，随着行业去库存逐步到位，数据中心、汽车电子、消费电子等重点行业对集成电路需求增加。中国集成电路成熟制程产业链逐步完善，先进制程工艺取得突破，增强产业竞争力。2024 年，中国集成电路产业实现强势复苏，产业规模达 14,419.1 亿元、同比增长 17.4%，进入新一轮快速发展阶段。



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》

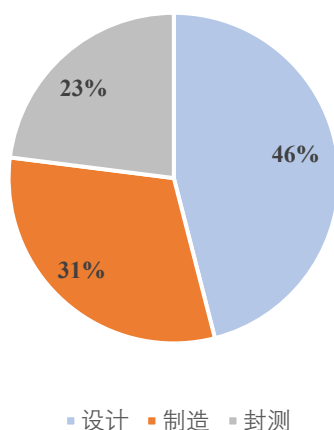
在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业保持快速增长，生产总量规模实现较大突破，根据国家统计局的数据，2023 年国内集成电路行业总生产量为 3,514.40 亿块，较 2022 年度增长 8.41%。2024 年国内集成电路行业总生产量为 4,514.20 亿块，较 2023 年度增长 28.45%。2025 年国内集成电路行业总生产量为 4,843.00 亿块，较 2024 年度增长 7.28%。总体而言，中国的芯片生产量在不断提高。



数据来源：国家统计局

从产业链分工情况来看，根据中国半导体协会统计数据，2024 年我国集成电路产业销售中，设计环节作为高附加值环节，其销售额占比从 2018 年的 38.57% 攀升至 2024 年的 46%，是产业链中销售额最大的环节；制造环节销售额占比 31%；封测环节销售额占比 23%。设计、制造和封测三个环节大约呈 5：3：2 的比例，产业结构的均衡有利于集成电路行业专业化分工趋势的延续，芯片设计产业的快速发展，也能同时推动封装测试行业的加速发展。

2024年中国集成电路销售额构成



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》

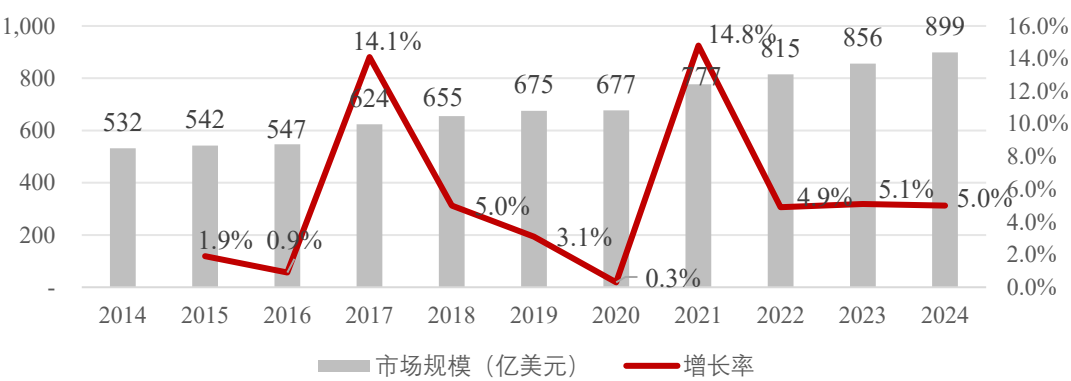
（2）封装测试市场

①全球封装测试市场

随着整个半导体产业的技术进步、市场发展、人力成本、政府政策扶持等因素的作用，全球半导体封测产业聚集中心已从起源地美、欧、日等地区逐渐分散到中国台湾、中国大陆、新加坡和马来西亚等亚太地区。

根据中国半导体行业协会信息显示，2024 年全球封测市场规模达到 899 亿美元，同比增长 5%。未来，全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好。2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元，先进封装市场规模将达 522 亿美元，占比提高至 54%。

全球封装测试销售额及增长情况



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》

根据《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》显示，2024 年全球前十大封装测试企业合计营收达到 313.6 亿美元，亚太地区依然是全球半导体封装测试业的主力军，全球前十大封装测试企业中，中国大陆有四家，中国台湾地区有三家，美国、新加坡和韩国各一家。

2024 年全球前十大集成电路封装测试企业

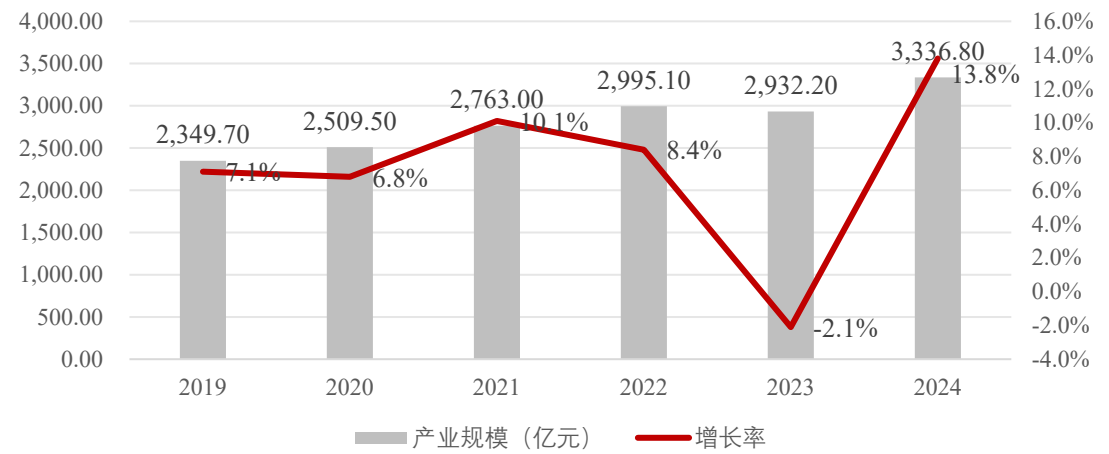
排名	公司	营业收入（亿美元）	总部所在地
1	日月光控股	99.8	中国台湾
2	安靠科技	63.2	美国
3	长电科技	47.6	中国大陆
4	通富微电	33.0	中国大陆
5	力成科技	20.5	中国台湾
6	天水华天	15.8	中国大陆
7	京元电子	11.5	中国台湾
8	UTAC 集团	8.3	新加坡
9	韩亚美光	7.3	韩国
10	盛合晶微	6.6	中国大陆

数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》

②中国封装测试市场

我国半导体封装测试是整个半导体产业中发展较为成熟的板块，在规模和技术能力方面与世界先进水平较为接近。近年来，我国集成电路封装测试业销售额逐年增长，2019-2024 年中国封测业复合增长率 7.27%。先进封装核心技术不断取得突破，满足新兴领域对先进封装技术的多元化需求，2024 年中国集成电路封测业规模大幅回弹，同比增速创近五年新高，产业规模达 3,336.80 亿元，同比增长 13.8%。

2019-2024年中国封测业规模及增长情况



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2025 年版）》

相对于芯片设计和晶圆制造产业来说，中国封装测试领域的技术水平和销售规模与国际知名企业的水平持平，以长电科技、通富微电和华天科技为典型代表，作为国内封装测试行业的龙头企业，已稳居全球封装测试企业前十强。

全球半导体产业经历二次产业转移，目前处于第三次产业转移的进程之中，作为半导体领域壁垒相对较低的领域，封测产业目前主要转移至亚洲区域，主要包括中国大陆、中国台湾、东南亚等。

我国半导体封测行业属于市场化程度较高的行业，衡量行业竞争力的关键指标通常包括技术创新能力、生产效率、产品质量、市场占有率、客户服务能力和供应链整合能力等。

我国半导体封测行业是中国大陆半导体发展较为完善的板块，技术能力与国际先进水平比较接近，我国封测市场已形成内资企业为主的竞争格局。从企业综合实力来看，大致可以将国内封装测试厂商进行如下划分，具体如下表所示：

国内半导体封装测试企业类别

类型	主要特征	主要优势	代表厂商
行业内规模或技术具有领先优势的企业	规模大、综合实力强、引领行业技术和产品创新，高效、严格的品质管理体系；外资企业以 BGA、CSP、WLCSP、FC、MEMS、Bumping、TSV 等为主，内资企业在先进封装产品市场已占有一定比例	技术、市场和资金优势	长电科技、华天科技、通富微电、盛合晶微及安靠科技、日月光等在国内设立的封装测试企业
具备一定规模、具备较强技术实力的中等规模企业	规模中等、具备较强的技术实力和完整的品质管控体系，专注于技术应用和工艺创新，以 SOT、SOP、QFP、QFN/DFN、LQFP 等系列产品为主，逐步向 CSP、FC、TSV、SIP 等先进产品延伸	拥有较强的研发和技术能力，具有完善的生产与质量管理体系；产品性价比高、竞争力强	以气派科技、华宇电子等为代表的中等规模企业
规模较小的企业	规模较小、技术或生产管理能力一般，主要以 TO、DIP、SOP 等产品为主	无明显优势	数量众多的中小型企业

在经过 2021 年市场行情高涨的一年后，2022 年至 2023 年，受宏观经济环境变化、行业周期波动等因素影响，半导体行业整体增速放缓，2024 年呈现强势复苏态势。企业能否积极应对市场变化、有效扩充产品终端应用领域，是企业经营业绩能否持续增长的关键。近期，长电科技、华天科技、通富微电、盛合晶微等领先企业均已将主要投资的重点放在汽车电子专业封测基地、Chiplet 等先进封装、新一代功率器件封装产能规划等项目上，减少现有工厂常规产品的技术和

产能更新的规模。短期来看，大量资金投入先进研发项目可能会对公司盈利造成一定负担。但长期来看，更丰富的产品结构、更广泛的终端应用领域是维持企业营收规模的关键要素。因此，未来半导体封装测试企业重心将倾向于中高端产品的研发投入，形成产品结构偏向中高端、大力拓宽产品应用领域的竞争格局。

3、行业发展趋势

（1）国际形势推动国产替代加速

中国半导体市场持续扩张，进口依赖依然明显。根据海关总署发布的最新数据显示，2025 年中国集成电路进口总量达 5,917 亿个，进口金额达 30,400 亿元人民币，分别同比增长 7.8%和 10.1%。集成电路产品连续第十七年位列中国进口金额第一位，表明国内对芯片的高度依赖尚未根本缓解。

与此同时，国际局势持续变化，进一步凸显了实现半导体自主可控在国家战略中的重要地位，芯片设计、制造、EDA 工具、封装测试等关键环节的国产化任务愈加紧迫。国家政策推动和企业战略调整下，以长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微等为代表的本土企业正加速推动国产替代，部分高端芯片封装测试订单正逐步转向国内厂商。根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告预测，2020-2025 年中国大陆地区晶圆产能占全球比例将从 18%提高至 22%，年均复合增长率约为 7%。随着“芯片国产化”浪潮全面推进，全球半导体产能正在向中国加速转移，封装测试作为制造后段的关键环节，也将迎来扩产周期与技术升级的双重机遇。

（2）5G 通讯等新应用需求带来的持续增长动力

除了当前消费电子等传统市场需求外，未来 5G 通信、智能汽车、人工智能（AI）、物联网（IoT）等新兴行业应用的快速发展，将加速人类社会向智能化、互联化、泛在化方向演进，推动形成“万物智联”的生态系统。这些技术不仅对芯片性能和功能提出更高要求，也为半导体产业开辟了新的增量空间，全球半导体产业有望在智能终端驱动下迎来新一轮景气周期。

以 5G 通信为例，2024 年全球 5G 基站部署已进入规模化阶段，各主要运营商持续推进网络覆盖，终端厂商也不断推出适配不同频段的 5G 智能设备。5G 的高速率、低延迟、大连接特性使得高清视频、AR/VR、远程医疗、工业互联网等

应用逐步落地，终端形态也趋于多元。同时，在 5G 终端中，半导体用量显著高于 4G 时代。一方面，因射频频段数量增加，射频前端模组、PA、滤波器等器件的集成度和价值量大幅提升；另一方面，高速传输需求带动 NAND 闪存容量显著提升，手机 SoC 对 AI 推理能力也提出更高要求。此外，5G 时代万物互联的设备爆发将显著拉动微控制器、传感器、模数混合 IC 等器件需求，进而驱动封装测试环节的持续扩容与技术升级。

以汽车电子为例，智能驾驶、信息娱乐、辅助决策等功能快速普及，使得汽车正从传统机械产品加速转型为高度集成的“智能终端”。芯片已广泛应用于动力控制、车载计算平台、传感器融合、通信连接等多个模块，特别是智能驾驶域控制器、激光雷达、毫米波雷达的量产落地，使车载高算力芯片与多类型封装需求同步提升。另一方面，新能源汽车渗透率持续攀升，驱动系统、电池管理、功率器件等新一代半导体方案快速替代传统控制系统，汽车成为当前增速最快的半导体应用市场之一，封测产业也因此进入强关联增长通道。

（3）先进封装推动封装市场进一步发展

摩尔定律及先进制程一直在推动半导体行业的发展，封装行业也需要新的技术来支持新的封装需求，如高性能 2.5D/3D 封装技术、晶圆级封装技术、高密度 SiP 系统级封装技术、高速 5G 通讯技术以及内存封装技术等将会成为接下来封装行业跟进产业潮流的主流技术及方向。

在大数据、人工智能和物联网的加持下，全球电子信息产业进入了一个裂变式发展阶段，5G 通讯终端、高性能计算（HPC）、智能汽车、数据中心等新兴应用正在加速半导体产业供应链的变革与发展，对封装工艺及产品性能提出了更高的要求，为先进封装产业注入了新动力。先进封装可以通过增加功能和保持/提高性能，来提升半导体产品的价值，同时降低成本。先进封装技术不仅在解决计算和电信领域的高端逻辑和存储器方面发挥着重要作用，还在向高端消费/移动领域进一步渗透模拟和射频应用。

（四）行业竞争情况及发行人地位

1、行业竞争格局及市场集中情况

目前，全球封装测试行业市场已经形成较为稳定的市场格局，具体请参见本章内容之“三、公司所处行业的管理体制、主要特点及行业竞争情况”之“（三）行业发展趋势”之“2、行业发展现状”之“（2）封装测试市场”。

2、发行人的市场地位、主要竞争对手

（1）发行人的市场地位

公司在半导体直插封装和贴片封装产品领域具有较强的成本控制和质量管理优势，是国内封装测试技术应用型代表企业之一。

自 2006 年成立以来，公司业务增长快速，与兆易创新、普冉股份、英集芯、芯迈半导体、钰太科技、天钰科技、上海贝岭、矽力杰、晟矽微电、蕊源科技、博威公司等企业建立了稳固的合作伙伴关系，在产品质量、交货期、专业服务等方面赢得了客户的高度认可。2025 年公司半导体封装年销量达到 119.68 亿只，营业收入达到 7.69 亿元。公司已发展成为华南地区技术工艺先进、产品系列相对齐全、产销量规模最大的内资半导体封装测试企业之一。

（2）主要竞争对手

与公司形成竞争关系的国内上市的封装测试企业主要为长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子和华宇电子，其具体情况如下：

（1）长电科技

长电科技成立于 1998 年 11 月，2003 年 6 月在上海证券交易所上市。长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商，向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案，涵盖微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术，包括晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D 封装、系统级封装（SiP）、倒装芯片封装、引线键合封装及传统封装先进化解决方案，广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。

（2）通富微电

通富微电成立于 1997 年 10 月，2007 年 8 月在深圳证券交易所上市。通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务，产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。

（3）华天科技

华天科技成立于 2003 年 12 月，2007 年 11 月在深圳证券交易所上市。华天科技主营业务为集成电路封装测试，目前集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

（4）甬矽电子

甬矽电子成立于 2017 年 11 月，2022 年 11 月在上海证券交易所上市。甬矽电子封装产品主要包括高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping 及 WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系统传感器（MEMS）五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片，AP 类 SoC 芯片，触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网 AIoT 芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。

（5）华宇电子

华宇电子成立于 2014 年 10 月，2024 年 10 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华宇电子主营业务包括集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试，封装测试产品主要有 SOP、QFN/DFN、SOT、TO、LQFP、LGA、FCLGA、BGA、FCBGA 等多个系列，共计超过 130 个品种；测试晶圆的尺寸覆盖 12 吋、8 吋、6 吋、5 吋、4 吋等多种尺寸，包含 22nm、28nm 及以上晶圆制程；芯片成品测试方面，公司已累计研发出 MCU 芯片、ADC 芯片、FPGA 芯片、车规传感器芯

片、存储芯片、磁传感器芯片等累计超过 30 种芯片测试方案。

（五）行业技术壁垒或主要进入障碍

（1）技术壁垒

半导体封测行业属于技术密集型行业，技术门槛较高。近年来，随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新业态快速发展，半导体的下游产品逐渐向小型化、智能化的趋势发展，我国半导体封测的技术水平、产品结构等也需要紧跟下游产品的趋势，这对半导体的封装测试提出了非常高的技术要求。另外，半导体的下游应用领域逐渐扩大，下游广泛的应用领域对半导体产品的性能和成本提出了差异化的要求。

因此，行业内企业需要拥有丰富的技术、工艺经验储备，才能根据市场的实时需求及时创新，自主研发出高质量且满足市场需求的产品。而新进入企业很难在短时间内掌握先进技术，亦难以持续保持技术的先进性，构成了较高的技术壁垒。

（2）人才壁垒

半导体封测行业同时也是人才密集型行业，管理团队和技术团队是保持公司技术创新能力的核心资源，公司需要能够将理论研究与实际生产相结合的专业性人才，才能更好地提升公司的技术水平、研发能力和生产管理能力，保证生产效率、产品成本与质量、交货期的稳定性，构成了较高的人才壁垒。

（3）资金壁垒

半导体封测行业属于资本密集型行业，前期投入大、回报周期长、投资风险大，这就要求企业保持较高的营运资金水平。另外，行业技术更新换代快，产品竞争激烈，对企业的研发投入和人才投入等也有较高的要求。这对行业新进入者形成较高的资金壁垒。

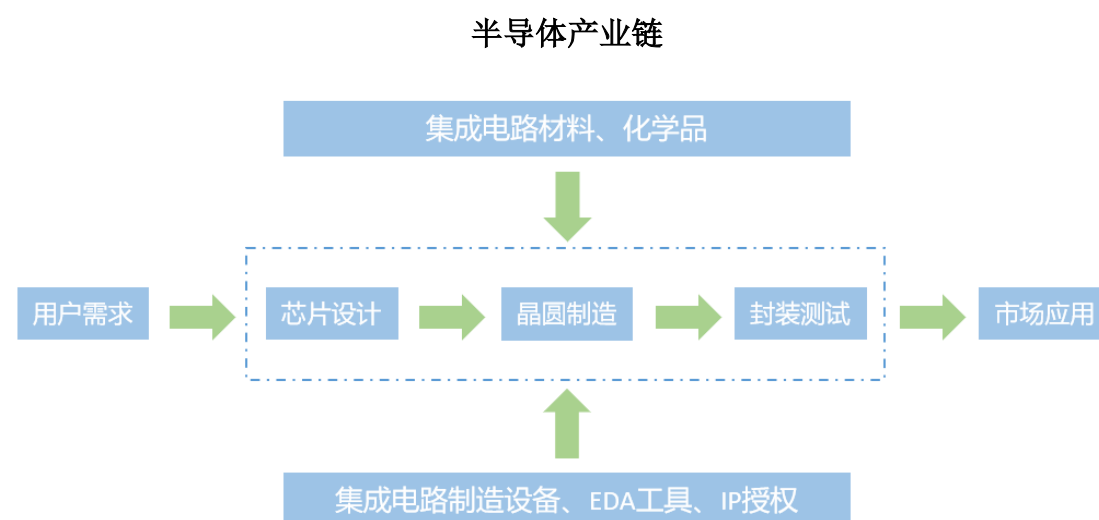
（4）客户认证壁垒

下游产品的质量、性能很大程度上受到半导体封装测试的影响，下游客户通常对供应商有较严格的认证条件并进行认证测试，要求供应商具备行业内较领先的技术、高性价比的产品、优质的服务以及稳定的量产能力。新进入者通过下游

客户的认证需要一定的周期以及较高的条件，这对新进入者形成了较高的客户认证壁垒。

（六）发行人所处行业与上下游行业的关联及上下游行业发展状况

半导体主要包括芯片设计、晶圆制造和封装测试三大产业链，此外还有材料、化学品及专业设备等作为支撑产业链。半导体产业具有资本密集和技术密集的特征，业内企业间比拼的核心要素包括研发能力、技术水平、生产管理、品质管控、资金实力和产业链整合能力。



芯片设计环节是根据芯片规格要求，通过架构设计、电路设计和物理设计，最终形成设计版图，其上游为 EDA 等工具供应商和 IP 授权供应商，分别提供芯片设计所需的自动化软件工具和搭建系统级芯片所需的功能模块。

晶圆制造环节是根据设计出的电路版图，通过炉管、湿刻、淀积、光刻、干刻、注入、退火等不同工艺流程在半导体晶圆基板上形成元器件和互联线，最终输出能够完成功能及性能实现的晶圆。

为了满足市场需求，半导体设计厂商在线路设计和版图转换时，会综合考虑晶圆制造厂商和封装测试厂商的工艺技术能力，以期最终实现所设计集成电路产品功能的最优化。晶圆制造和封装测试环节在整个集成电路产业链上扮演着专业生产角色，实现了产品从设计图纸到成品的转变。随着先进封装技术的不断应用和推广，集成电路设计厂商进一步加强了与封装测试厂商的合作，因此集成电路的封装测试工艺水平已成为集成电路初始设计就应予以考量的重要要素。

四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司主要业务模式

1、采购模式

公司设置采购部、计划部等部门，根据公司生产需要，针对封装测试加工所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购，除此之外，公司还对生产设备、外协加工服务项目进行采购，具体的采购环节如下：

（1）采购计划

1) 物料采购

计划部根据销售订单情况制定出 2 至 3 个月物料需求计划，采购部根据物料需求计划、库存情况、在途订单以及每月物料用量制定相应采购计划，经采购部经理审核、分管采购的副总经理批准。批准后，采购部下达采购订单，采购订单经采购经理、分管采购的副总经理核准后，下达给相应的供应商，供应商按照要求向公司供货。引线框架价格每月进行报价比价；丝材根据国际价格的走势择机采购；塑封料根据采购量不同实行阶梯价格采购；其他材料根据市场情况以及采购量的增加进行定期或不定期的议价比价。

2) 设备、服务类采购

需求部门人员提交采购申请，经需求部门经理审核，再经分管副总经理或总经理批准后，采购部进行询价议价，经分管采购的副总经理确认后选定供应商。在完成公司内部合同审批流程后，公司与供应商签订《采购合同》，采购部下达《采购订单》，供应商按合同要求交货。

（2）材料的入库和验收

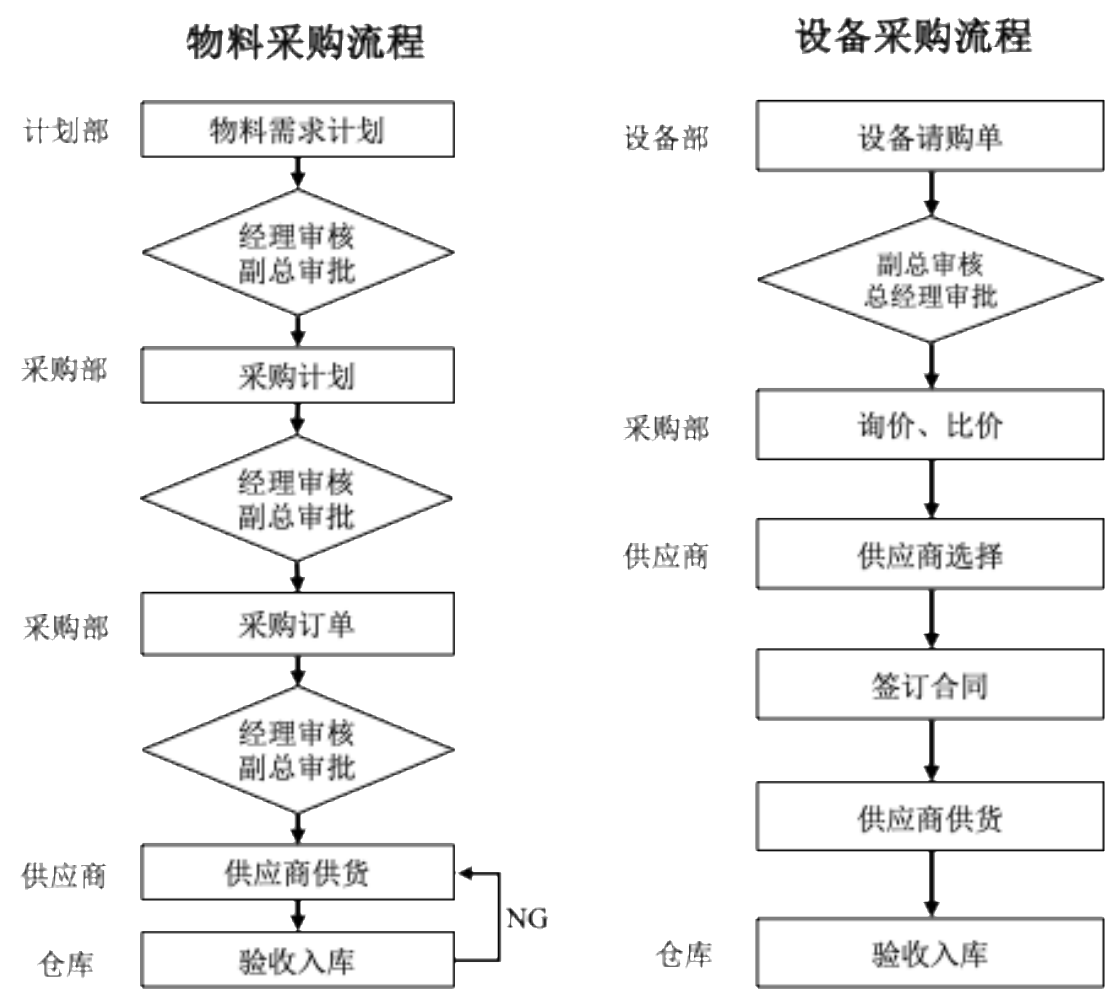
物料到货后，仓库根据《送货单》与实物进行核对，无误后品质部来料质量检测人员根据公司的来料检验要求进行检验，合格后仓库收货；如有质量异常反馈，采购部进行后续处理。

设备按照合同到货后由设备部进行试装试产，并在合同规定时间内提供验收报告进行验收。

（3）供应商选择

公司选择新供应商的来源主要分为三部分，一是研发部根据所开发的新产品的工艺要求，确定相应供应商，二是采购部为了优化供应商结构并实现降低成本的目的而遴选的供应商，三是客户指定的供应商。采购部通过接洽、实地考察等方式，综合工艺水平、质量、价格、产能、供货及时性、物流及地理位置等因素，对供应商进行评价并择优选用。

对现有的供应商，采购部配合品质部，按季度和年度进行评定，从交货质量、交期、价格、服务等方面进行考核，对于考核合格的供应商，继续保持合作关系。



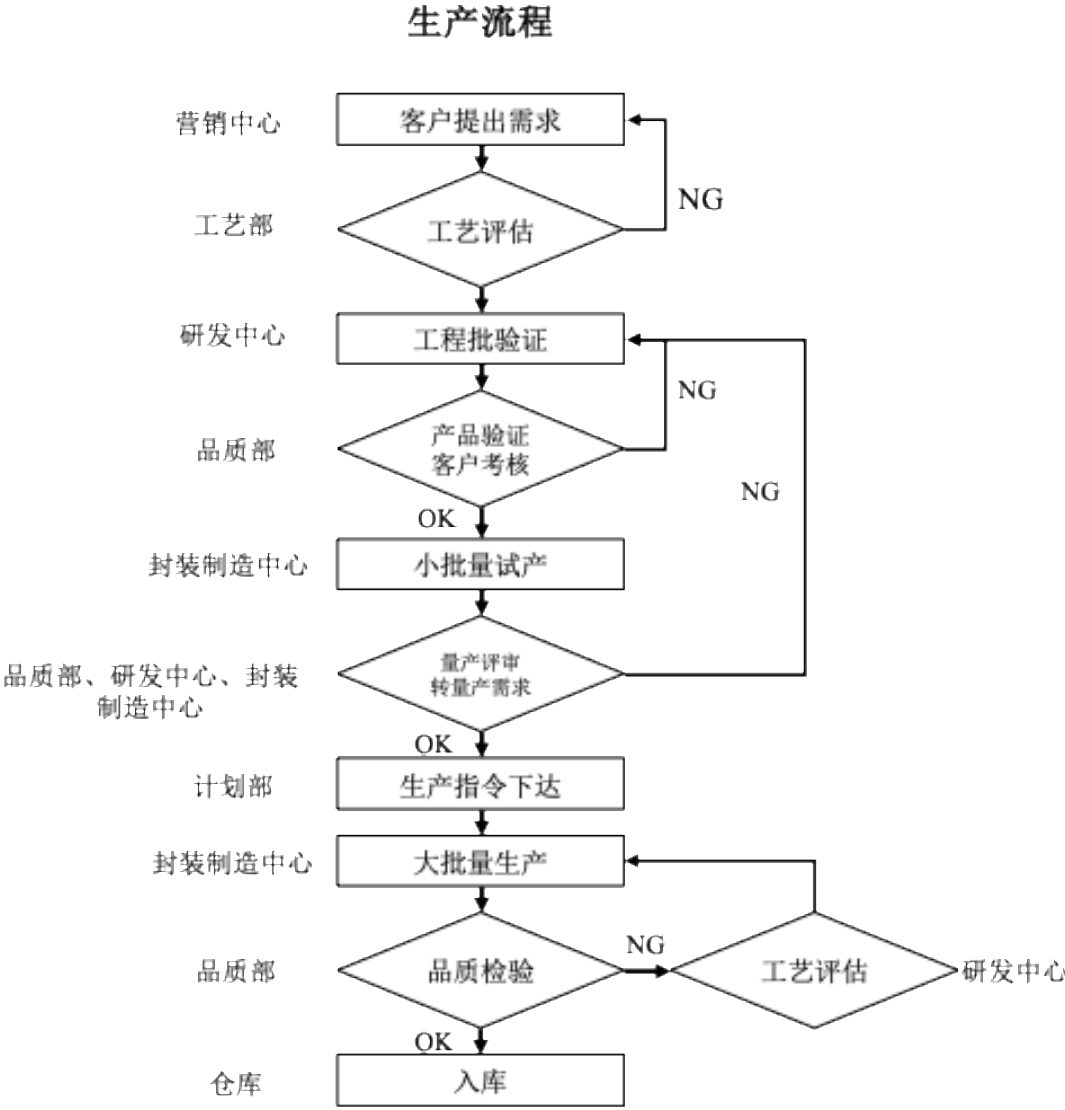
和产量能够快速灵活的调整，形成了以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式。

（1）大批量生产条件的验证

公司生产过程以营销中心为起点，产品主要按照客户的需求实行定制化生产，客户对封装测试产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求。客户提出产品封装测试的需求后，营销中心将产品需求提交给工艺部，工艺部对是否能承接生产任务进行评估，评估通过后由工艺部进行工程试验，工程验证通过后，公司设计、生产相应样件并提交客户认定，通过认定后转由生产部开展小批量试产，小批量通过再由品质部、生产部、工艺部等组成的评审会审核是否满足大批量生产条件。

（2）大批量生产环节

产品满足大批量生产条件后，由客户提供具体封装测试需求计划，营销中心把需求计划传递给计划部，计划部依据产能情况评估计划承接业务量，营销中心根据计划部评估的生产承接量接受客户订单。营销中心接受客户订单后，将客户订单信息传递给计划部，计划部根据客户的产品规格、质量要求、供货时间等要求制定生产计划。生产部根据计划部的指令安排生产，确保生产任务的达成，生产过程包括减薄、划片、装片、键合、塑封打印、电镀、切筋成型、测试、包装等一系列工艺环节。品质部负责各环节产品质量的跟踪检测，评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，所有产品经品质部检验合格后才交付给客户。



3、销售和盈利及管理模式

(1) 销售模式

公司销售环节采用直销模式，公司客户主要为芯片设计公司。绝大部分芯片设计公司由于本身无晶圆制造环节和封装测试环节，其自身只根据市场需求设计集成电路版图。该等芯片设计公司完成芯片设计后，将其交给晶圆代工厂制造晶圆，晶圆完工后交给公司，由公司对晶圆进行封装测试，之后芯片设计公司将公司封装测试后的集成电路销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

公司目前已建立一支营销能力强、经验丰富的专业销售团队，通过直接洽谈、客户引荐、参与行业展会等方式获取客户资源，公司已形成了以华南、华东为主，其他区域为辅的销售战略布局。

（1）客户获取方式

1）客户主动联系

公司经过近二十年的经营积累，已经具备一定的品牌知名度及市场影响力，公司通过网站介绍公司优势及主营封装测试产品，并公布主要销售人员的联系方式，新客户会通过公开的联系方式与公司建立业务联系。

2）老客户引荐

公司产品除主要应用于消费电子领域外，还应用于信息通讯、智能家居、物联网、汽车电子、工业应用等领域，与数百家客户建立稳定合作关系，公司的老客户也在不断为公司引荐新客户。

3）公司主动开发

公司销售人员结合行业发展趋势、公司发展战略、技术研发方向和前沿产品开发情况，主动对目标客户进行战略布局，通过参加行业展会、网络渠道等方式获取潜在客户信息，后续主动联络及拜访该等潜在客户。主动开发客户的策略使得公司营销内容紧跟行业发展方向、持续契合市场需求，公司也在该过程中实现了产品结构升级、客户结构优化。

（2）销售政策

1）定价方式：半导体封装测试属于充分竞争的行业，同时封装测试产品往往具备定制化的特点，公司产品定价通常根据客户封装测试产品的具体内容并结合市场价格情况，由供需双方协商确定。

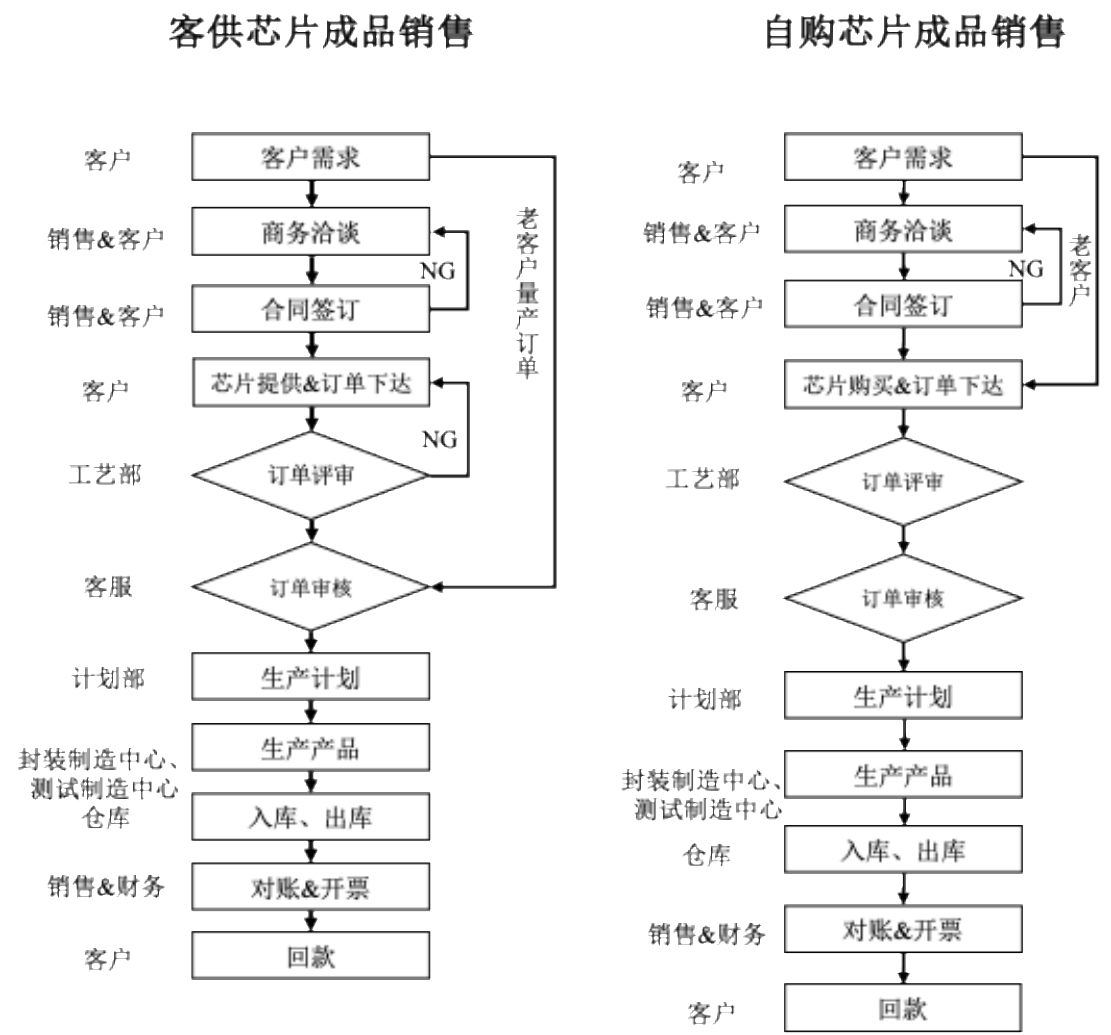
2）信用政策：公司对不同客户采取不同的信用政策，主要考虑客户市场影响力、增长潜力、资产状况及付款信誉等因素，由双方协商确定信用期。

3）结算方式：公司与客户的结算方式主要为银行转账和银行承兑汇票。

（3）销售流程

客户封装测试产品如为需要公司进行工艺验证的产品（即公司首次导入产品），则销售中心会先将产品需求提交给工艺部，由工艺部组织品质、生产等部门进行工艺验证。工艺验证通过后，公司才会与客户达成合作意向。客户封装测试产品如为公司前期已通过工艺验证的成熟产品，则无需工艺验证，由营销中心提交申请经审批后即达成合作意向。

公司与客户达成合作意向后，通常会先签署框架合同。之后，客户根据其自身的生产经营计划，与公司营销中心确定采购产品单价、数量、工艺技术要求、交货时间等具体事项后下达采购订单。公司营销中心下属客服部将需求计划提交给计划部，计划部组织生产相关部门完成生产环节，完成产品入库。产品出库并经客户验收后，营销中心与客户定期进行对账，客户按照双方约定信用期完成付款。



（2）盈利模式

公司从事半导体封装测试一站式服务，主要业务分为集成电路封装测试、功率器件封装测试、晶圆测试。

①集成电路封装测试业务

客户向公司提供晶圆，公司采购引线框架、丝材、装片胶和塑封树脂等原辅料，按照客户要求对其提供的晶圆芯片通过晶圆背部减薄研磨、晶圆切割、装片/固晶、键合/焊线、塑封、电镀、打标、切筋（切割）、测试、外观检测、包装等一系列加工工序加工出合格的芯片成品等进行一系列内部工艺加工以及外协辅助加工，公司完成芯片封装测试的精密加工后将成品交还给客户，向客户收取封装测试加工费，获取收入和利润。

此外，在了解客户需求的基础上，公司会自行采购一些通用芯片的晶圆，在公司封装测试产能允许的条件下进行封装测试形成芯片成品，在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户，从而平衡公司产能、以及取得收入和获取利润。客供芯片封装测试由客户提供晶圆芯片，自购芯片封装测试由公司自行采购晶圆芯片；除此以外，公司的客供芯片封装测试和自购芯片封装测试的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

②功率器件封装测试业务

功率器件封装测试业务的业务模式与集成电路封装测试业务一致，由客户向公司提供晶圆，公司通过晶圆切割、装片/焊芯片、键合/压焊/铜夹焊/回流焊、塑封、电镀、打标、切割、测试、外观检测、包装等加工工序加工出合格的功率器件成品，公司将功率器件成品交还给客户，向客户收取封装测试加工费。

③晶圆测试业务

客户向公司提供晶圆，由客户提供或由公司自行开发测试程序，通过芯片测试设备和探针台对晶圆上的每一颗芯片的电气特性进行检测，将不合格的芯片标记出来，在后续的封装过程中，不合格的芯片将被淘汰，不再进行封装，避免增加封装和成品测试的成本。公司将晶圆测试完毕后交还给客户或转交给封装测试工序进行下一步加工，公司向客户收取晶圆测试服务费。

4、研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有研发中心，广东气派设有技术工程研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高研发人员的积极性，公司建立了研发创新的奖励制度。该奖励制度不仅提高了研发人员的工作积极性，还可以激励全体员工参与技术革新活动，取得了较为明显的成效。

公司研发活动按照以下流程开展：

（1）项目来源

公司研发项目主要来源于以下四个方面：一是研发中心对行业发展趋势做出深入调研后，结合公司发展战略和发展目标，有针对性地选择新技术、新工艺、新产品进行立项开发和技术攻关；二是公司承接政府部门的科技计划项目、创新基金项目、重大科技项目等征集项目或技术攻关项目；三是公司营销中心通过对市场需求进行综合调研后，针对前景广阔且市场需求大的新产品、新技术、新工艺提出立项；四是来源于客户定制化产品的研发需求。

（2）项目立项

研发中心接到新产品需求信息后，研发中心负责人会指定经验丰富的人员对产品信息进行初步论证，如初步论证可行，则召开项目立项会议，确定项目研发内容和项目负责人并组建项目组，正式启动项目研发工作。

（3）设计和开发

项目组根据《产品责任书》及确定的设计和开发要求，开展设计和开发工作。设计和开发完成后，将召开评审会议，对项目是否已经完成设计和开发工作并取得相应的研发成果予以评定。

（4）反馈和纠正

项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给研发中心负责人。

（5）产品试制

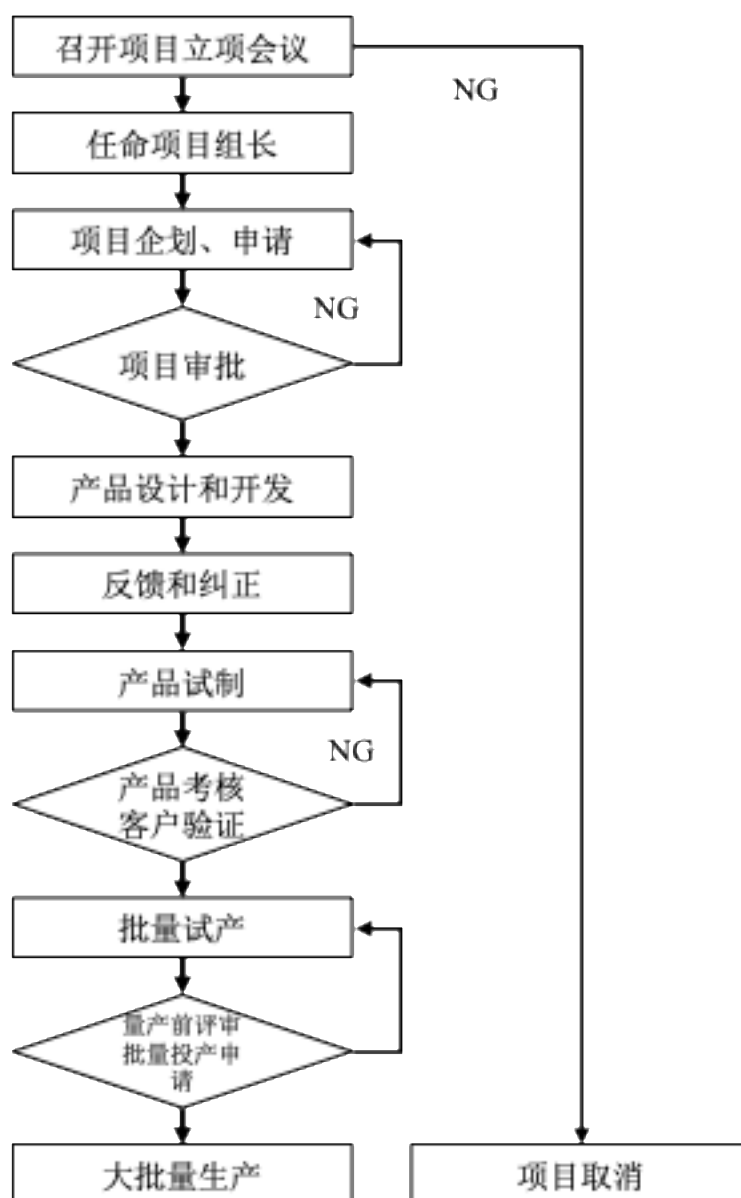
项目组在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打样，样品质量及性能由品质部负责检验和认定。如样品经检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品

的性能参数完全符合《产品责任书》的规定，则进入批量试生产阶段。

（6）小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。项目组指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合《产品责任书》规定的要求，项目组会提请召开量产前评审会。评审会通过项目提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，项目组将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作结束。

研发流程



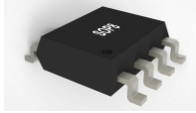
(二) 产品或服务的主要内容

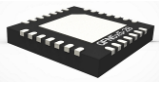
公司主营业务为半导体封装测试，经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。同时，公司正逐步开展半导体产业封装中的前端工序晶圆测试业务，以进一步完善公司在半导体封装测试领域的产业布局。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，注重半导体封装测试技术的研发升级，通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司掌握了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

公司始终专注于向客户提供更有竞争力的封装测试产品，通过持续不断的研发投入，形成的集成电路封装主要产品有 MEMS、FC、5G 氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、QIPAI、DIP 等多个系列产品共计超过 300 种封装形式，产品主要运用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域；功率器件封装主要产品为紧凑型表面贴装器件封装（PDFN/PQFN）、晶体管封装（TO）、功率模块封装（IPM）、铜夹焊封装（LFPAK）等。除此以外，公司还为客户提供晶圆测试服务。

公司主要封装测试产品的特点及其应用领域情况如下：

产品类型	产品介绍	产品展示	产品特点	应用领域
SOP	Small Outline Package 的缩写，小外形封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）		是一种非常常见的表面贴装型封装形式。引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形），材料有塑料和陶瓷两种。后来，由 SOP 衍生出了 SOJ（J 型引脚小外形封装）、TSOP（薄小外形封装）、VSOP（甚小外形封装）、SSOP（缩小型 SOP）、TSSOP（薄的缩小型 SOP）等	该类型封装的典型特点是在封装芯片的周围做出很多引脚，封装操作方便，可靠性比较高，是目前的主流封装方式之一。目前比较常见的是应用于一些存储器类型的 IC、电源管理类芯片

产品类型	产品介绍	产品展示	产品特点	应用领域
SOT	Small Outline Transistor 的缩写，小外形晶体管贴片封装，是表面贴装型封装之一，一般引脚小于等于 8 个的小外形晶体管和集成电路		相对于 SOP 而言，SOT 是 8 脚或以下器件的贴片封装形式，尺寸较小些。而 SOP 一般是 8 脚或以上器件的贴片封装形式，尺寸较大些	SOT 多用于三极管、MOS 管和稳压器等上，适应物联网智能终端更小更快的发展趋势，进一步降低系统成本
QFN/DFN	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即四边扁平无引脚封装；Dual Flat No-lead 的缩写，双边扁平无引脚封装，DFN 的设计和与应用与 QFN 类似。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周		适用于表面贴装封装，是具有多个电极触点和一个用于机械和热量完整性暴露的芯片垫的无卤封装。无引脚焊盘设计使其占有更小的 PCB 面积。组件较薄（< 1mm），可满足对空间有严格要求的应用。考虑到成本、体积各方面的因素，QFN/DFN 封装将会是未来几年的一个增长点，发展前景较为乐观	从市场的角度而言，QFN/DFN 封装越来越多地受到用户的关注，常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用，可用于笔记本电脑、数码相机、个人数字助理（PDA）、移动电话等便携式消费电子产品
LQFP	Low-profile Quad Flat Package 的缩写，薄型四边扁平式封装技术		该技术实现的芯片引脚之间距离很小，管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式，其引脚数一般都在 32 以上，最多可以拓展至数百个引脚。该技术封装芯片时操作方便，可靠性高，而且其封装外形尺寸较小，寄生参数减小，适合高频应用	应用广泛，很多 MCU 芯片都采用了该封装，在工业自动化、变频器等上多有应用
CPC	由气派科技自主研发并定义的表面贴片式系列封装形式		CPC 封装技术结合了 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优点，而且更具成本优势，是气派科技自定义 Qipai 产品后的又一次创新。CPC 封装顺应了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求，同时兼顾了各种封装的优点，如对封装体积敏感、对散热性要求高的 LED 驱动芯片、低功率类产品的贴片封装，气派科技已有 CPC4、CPC5 封装解决方案提供给客户；对于一般 IC 封装，气派科技有 CPC8/14/16/20/24 封装解	替代 SOP、SOT 和小部分 QFN/DFN 封装产品，适用于封装体积敏感、对散热性要求高的 LED 驱动芯片、低功率类产品等

产品类型	产品介绍	产品展示	产品特点	应用领域
			决方案可替代。对于有散热要求的产品，气派科技有 ECPC 系列封装解决方案提供给客户	

报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
SOT	6,559.76	30.66%	24,357.07	33.08%	18,633.74	29.72%	17,750.45	34.05%
SOP	4,931.60	23.05%	15,941.50	21.65%	16,813.43	26.82%	14,099.48	27.04%
DFN/QFN	7,607.81	35.56%	25,181.57	34.20%	20,099.06	32.06%	13,703.89	26.29%
CPC	453.60	2.12%	2,163.56	2.94%	2,073.02	3.31%	2,057.07	3.95%
LQFP	276.18	1.29%	529.65	0.72%	577.92	0.92%	937.92	1.80%
其他	1,200.46	5.61%	4,716.29	6.41%	4,193.50	6.69%	3,484.45	6.68%
晶圆测试	364.04	1.70%	744.79	1.01%	309.45	0.49%	100.57	0.19%
合计	21,393.45	100.00%	73,634.44	100.00%	62,700.12	100.00%	52,133.82	100.00%

（三）最近三年一期发行人主要产品的生产销售情况

报告期内，公司产能、产量及销量情况如下所示：

期间	类别	产能	产量	销量	产能利用率	产销率
2026 年 1-3 月	封装测试（亿只）	38.32	33.32	32.23	86.97%	96.72%
	晶圆测试（万片）	6.00	3.79	3.66	63.19%	96.53%
2025 年	封装测试（亿只）	134.82	119.34	119.68	88.52%	100.28%
	晶圆测试（万片）	15.66	9.56	8.28	61.05%	86.56%
2024 年	封装测试（亿只）	134.02	107.98	105.71	80.57%	97.90%
	晶圆测试（万片）	7.90	4.30	4.10	54.43%	95.35%
2023 年	封装测试（亿只）	131.71	89.74	89.82	68.13%	100.09%
	晶圆测试（万片）	4.32	1.10	0.96	25.46%	87.27%

报告期内，公司产能与产量整体保持扩张态势。2023 年以来，随着公司募投项目的实施和机器设备持续投入，产能有所增长，但在 2023 年，下游市场需求

较为低迷，因此 2023 年发行人产能利用率较低。2024 年起，终端行业需求和半导体行业需求逐步复苏，公司产品销量提升，公司产能利用率逐年提升。报告期内公司封装业务产销率保持较高水平。

（四）主要固定资产、无形资产及经营资质

1、主要固定资产

（1）固定资产概况

公司固定资产主要为房屋建筑物及机器设备，截至 2026 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	折旧年限（年）	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	40	35,108.73	30,387.44	86.55%
房屋建筑物装修	10	16,728.75	9,458.55	56.54%
机器设备	10	161,985.05	86,674.47	53.51%
通用设备	5	7,960.79	2,228.92	28.00%
运输工具	5	264.32	36.65	13.87%
其他设备	5	6,743.65	2,026.82	30.06%
合计		228,791.30	130,812.85	57.18%

截至 2026 年 3 月 31 日，公司固定资产的整体成新率为 57.18%，保持较好的使用状态。

（2）自有房屋建筑物

截至 2026 年 3 月 31 日，公司共有 9 处房产，具体如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落	土地					房屋				他项权利
				权利类型	权利性质	用途	宗地面积	使用期限	权利类型	权利性质	用途	建筑面积	
1	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第 0119369 号	东莞市石排镇气派科技路 1 号	国有建设用地使用权	出让	工业用地	66,670.10m ²	至 2064.3.16	房屋所有权	自建	生产厂房	64,878.91 m ²	抵押（注）、
2	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第 0119366 号							房屋所有权	自建	宿舍及食堂	26,971.17 m ²	
3	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第 0119366 号							房屋所有权	自建	动力站	3,312.60 m ²	

序号	权利人	不动产权证书号	坐落	土地					房屋				他项权利
				权利类型	权利性质	用途	宗地面积	使用期限	权利类型	权利性质	用途	建筑面积	
		权第0119361号							权				
4	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第0119364号							房屋所有权	自建房	废水处理站	803.23 m ²	
5	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第0119365号							房屋所有权	自建房	气站	343.00m ²	
6	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第0119354号							房屋所有权	自建房	门卫1	91.00 m ²	
7	广东气派	粤（2017）东莞不动产权第0119367号							房屋所有权	自建房	门卫2	41.11 m ²	
8	广东气派	粤（2025）东莞不动产权第0282130号							房屋所有权	自建房	废水处理站	2,828.12平方米	抵押
9	广东气派	粤（2025）东莞不动产权第0282146号							房屋所有权	自建房	厂房	87,894.96平方米	抵押

注：广东气派将其拥有的上述九项房产抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行，在2025年6月12日至2035年12月31日期间该银行对气派科技享有的最高余额不超过40,000万元范围内的债权提供担保；广东气派将其拥有的上述九项房产抵押给中国银行股份有限公司东莞分行，在2022年10月31日至2042年10月31日期间该银行对广东气派享有的最高本金余额不超过28,165.00万元范围内的债权提供担保。

（3）房屋租赁情况

①租出房产

报告期内，公司对外出租的房产情况如下：

序号	承租方	租赁房产所在地	面积/建筑面积（m ² ）	授权/租赁期限	用途
1	东莞市金晨热能技术有限公司	气派大厦生产大楼六楼部分区域	2,750.00	2025.1.1-2025.12.31	仓储
2	东莞市金晨热能技术有限公司	气派大厦生产大楼六楼部分区域	2,750.00	2024.1.1-2024.12.31	仓储
3	东莞市尧东机械制造有限公司	气派大厦生产大楼三楼部分区域	4,432.00	2024.1.10-2030.1.9	生产

序号	承租方	租赁房产所在地	面积/建筑面积 (m ²)	授权/租赁期限	用途
4	东莞市译码半导体有限公司	气派大厦生产大楼四楼部分区域	319.00	2023.2.1-2026.1.31	生产
5	广东芯测智联有限公司	气派大厦生产大楼五楼部分区域	2,925.00	2019.5.1-2031.4.30	生产
6	柯华贵/柯嘉兴/东莞市金晨热能技术有限公司	气派大厦生产大楼六楼部分区域	2,793.00	2023.01.01-2023.12.31	仓储
7	芯派科技(东莞)有限公司	气派大厦生产大楼六楼部分区域	231.00	2025.8.1-2028.7.31	办公
8	欧麦嘉(深圳)文化创意有限公司	气派科技园二期生产大楼十一楼东面区域	4,166.30	2025.6.10-2026.3.9	仓储
9	东莞市丰云云仓仓储有限公司	气派科技园二期生产大楼九楼整层区域	7,388.75	2025.5.8-2028.5.7	仓储
10	广东芯智造半导体有限公司	气派科技园二期生产大楼六楼整层区域	7,944.43	2025.6.1-2035.5.31	生产
11	深圳市哇偶文化传媒有限公司	气派科技园二期生产大楼十一楼西面区域	3,188.00	2025.11.20-2028.11.19	仓储

②租入房产

报告期内，公司租赁的生产经营厂房情况如下：

序号	出租方	租赁房屋所在地	面积/建筑面积 (m ²)	授权/租赁期限	是否具有产权	用途
1	成都迈亚美酒店管理有限公司	成都市高新区天府大道中段 500 号 1 栋 43 楼 4311 号	52.16	2023.10.16-2024.10.15	是	办公
2	惠州金茂实业投资有限公司	金茂源(惠州)表面处理循环经济产业园 605 栋厂房第五层	2,774.55	2025.3.1-2030.2.28	是	生产
3	上海弈佳企业管理有限公司	上海市浦东新区张江路 505 号展想中心 1 号楼 18 层 01-1	146.17	2025.2.1-2028.1.31	是	办公
4	深南(无锡)车联网商业管理有限公司	无锡市锡山区安镇街道春风南路 2 号智行科创园 8 幢 3 单元 305 室	209.28	2023.11.1-2025.10.31	是	办公
5	深圳市华宇轩电商产业园管理有限公司	深圳市龙岗区平湖街道平龙西路 250 号 1#厂房 301-2 号	265.00	2023.7.1-2026.6.30	是	生产
6	深圳市金百润实业有限公司	深圳市龙华区民治街道民康社区 1970 科技园 6 栋 3 楼 302	50.00	2023.12.01-2025.11.30	是	办公
7	深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	深圳市南山区沙河街道中新街社区兴隆街 1 号汉唐大厦 2602 单元	120.86	2025.7.20-2027.7.19	是	办公
8	爱苙杰商务服务(上海)有限公司无锡第二分公司	江苏省无锡市梁溪区人民东路 311 号崇文大厦 14 楼	16.13	2025.12.1-2026.11.30	是	办公

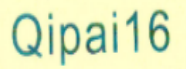
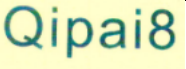
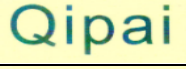
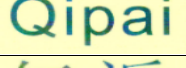
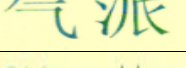
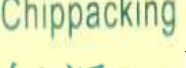
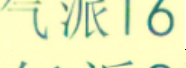
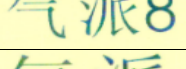
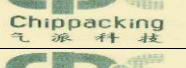
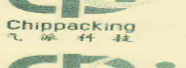
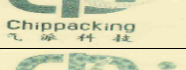
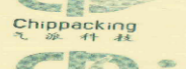
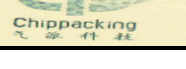
2、无形资产

(1) 土地使用权

公司子公司广东气派通过出让方式获得 1 宗工业用地使用权，位于东莞市石排镇福隆村，面积为 66,670.10 平方米，土地证号为东府国用（2014）第特 112 号，终止日期为 2064 年 3 月 16 日。2017 年 6 月 23 日，广东气派依据《不动产登记暂行条例》及《不动产登记暂行条例实施细则》的相关规定，获得换发的土地使用权及房屋所有权登记合一的《不动产权证书》。

(2) 商标

截至 2026 年 3 月 31 日，公司正在使用的商标共计 19 项，具体情况如下：

序号	商标	申请人	注册号	注册类别	有效期限	注册地	取得方式
1		气派股份	10645113	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
2		气派股份	10645114	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
3		气派股份	10645115	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
4		气派股份	10645117	第 9 类	2013.11.28-2033.11.27	中国	原始取得
5		气派股份	10645118	第 9 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
6		气派股份	10645128	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
7		气派股份	10645129	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
8		气派股份	10645130	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
9		气派股份	10645131	第 40 类	2013.5.14-2033.5.13	中国	原始取得
10		气派股份	11232782	第 40 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得
11		气派股份	11232783	第 9 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得
12		气派股份	11232784	第 40 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得
13		气派股份	11232785	第 9 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得
14		气派股份	11232786	第 40 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得
15		气派股份	11232787	第 9 类	2013.12.14-2033.12.13	中国	原始取得

序号	商标	申请人	注册号	注册类别	有效期限	注册地	取得方式
16		气派股份	18897431	第 9 类	2017.2.21-2027.2.20	中国	原始取得
17		气派股份	18897527	第 9 类	2017.2.21-2027.2.20	中国	原始取得
18		气派股份	37638495	第 9 类	2020.3.28-2030.3.27	中国	原始取得
19		气派股份	37648808	第 40 类	2020.3.28-2030.3.27	中国	原始取得

(3) 专利权

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已获得的国内外专利 322 项，其中发明专利 56 项，外观专利 73 项，实用新型专利 193 项，具体情况参见本募集说明书“附录”之“一、专利”。

(4) 软件著作权

截至 2026 年 3 月 31 日，公司取得的软件著作权情况如下：

序号	著作权人	编号	软件名称	开发完成日	取得方式
1	气派科技	2013SR038072	TESTOS 软件[简称：TESTOS]V2.0	2012.10.1	自主研发

3、主要经营生产资质

截至 2026 年 3 月 31 日，公司取得的业务资质如下：

序号	业务资质名称	权利人	资质编号	颁发/授予机构	颁发时间	到期时间
1	国家高新技术企业证书	气派科技股份有限公司	GR202344204067	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	2023.11.15	有效期三年
2	海关认证企业证书	气派科技股份有限公司	795419672001	中华人民共和国深圳海关	2015.12.9	-
3	报关单位注册登记证书	气派科技股份有限公司	4403962659	中华人民共和国深圳海关	2017.3.6	长期
4	质量管理体系认证证书	气派科技股份有限公司	CN21/30922	SGS	2024.6.4	2027.6.3
5	环境管理体系证书	气派科技股份有限公司	01224E20496R2L	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024.6.27	2027.6.6

6	职业健康安全管理体系认证证书	气派科技股份有限公司	01224S30497 R1L	广州赛宝认证中心服务有限公司	2025.7.8	2027.6.26
7	有害物质管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN21/30071	SGS	2024.1.13	2027.1.12
8	国家高新技术企业证书	广东气派科技有限公司	GR202344015846	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2023.12.27	有效期三年
9	报关单位注册登记证书	广东气派科技有限公司	4419960N25	中华人民共和国黄埔海关	2019.1.8	长期
10	固定污染源排污登记表	广东气派科技有限公司	无	东莞市生态环境局	2024.7.3	2029.7.2
11	质量管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN21/30922.02	SGS	2024.6.4	2027.6.3
12	环境管理体系证书	广东气派科技有限公司	01224E20496 R2L-1	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024.6.27	2027.6.6
13	职业健康安全管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	01224S30497 R1L-1	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024.6.27	2027.6.6
14	汽车行业质量管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	IATF0558179/CN2400007750	SGS	2024.12.9	2027.12.8
15	防静电管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN20/31373	SGS	2024.9.7	2027.9.6
16	有害物质管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN21/30071.01	SGS	2024.1.13	2027.1.12
17	业务连续性管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN23/00005300.01	SGS	2023.9.28	2026.9.27
18	固定污染源排污登记表	气派芯竞科技有限公司	无	东莞市生态环境局	2023.6.21	2028.6.20
19	质量管理体系认证证书	气派芯竞科技有限公司	CN21/30922.03	SGS	2024.6.4	2027.6.3
20	环境管理体系证书	气派芯竞科技有限公司	01224E20496 R2L-2	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024.6.27	2027.6.6
21	职业健康安全管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	01224S30497 R1L-2	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024.6.27	2027.6.6
22	有害物质管理体系认证证书	广东气派科技有限公司	CN21/30071.02	SGS	2024.1.13	2027.1.12

五、公司现有业务发展安排及未来发展战略

公司秉承成为“国际一流的封装测试企业”的愿景，坚持以“严谨、高效、创新、发展”的经营理念 and 持续的“自主创新”精神，紧跟国内半导体行业的发展趋势，专注于半导体封装测试，不断创新，夯实领先的成本管控和质量管理优势，积极开拓市场，不断开发新的产品和新的技术，持续提高先进封装的技术和产能，从而提升公司的核心竞争力和市占率。

发行人历年来在制定发展计划的时候,充分考虑到了市场的发展状况以及发行人的实际情况,从而使得发展计划具有实施的可行性,保证了历年来发展计划基本完成。自公司上市以来,随着品牌知名度与市场认可度不断提高,2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-3 月,公司营业收入分别为 55,429.63 万元、66,656.25 万元、76,878.86 万元和 22,344.44 万元,2023 年第四季度半导体行业需求逐步复苏,公司经营规模呈上升趋势。

发行人以发展战略为导向,持续巩固和增强发行人在行业的市场优势地位,在立足现有半导体封装测试业务的基础上,开发先进封装产品,做大半导体封装测试业务规模,并逐步扩大先进封装产品的业务规模,实现成果转化。同时,发行人将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持续发展配备足够的人才储备。在此基础上,发行人将通过资本市场进行融资,增强资本实力,提高企业综合实力,最大化投资者利益。

六、报告期内公司的行政处罚情况

(一) 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责的情况

报告期内,公司不存在中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责的情况。

(二) 其他主管部门行政处罚等情况

报告期内,发行人及子公司受到的行政处罚情况具体如下:

1、海关行政处罚

2023 年 6 月 20 日,广东气派收到东莞海关出具的行政处罚决定书(莞关缉违字[2023]1020009 号),具体处罚情况如下:

①因广东气派在 2021 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 6 日,在执行 E5204B011129 等进料加工手册期间,未依照规定办理海关手续,将保税半成品集成电路外发至惠州天杰达电子科技有限公司、深圳市嵩恒升实业有限公司、广东芯测智联电子科技有限公司三家企业进行电镀、测试加工。截至 2022 年 5 月 7 日,上述外发加工保税半成品已全部收回。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第四项规定:“有下列行为之一的,处货物价值 5%以上 30%以下罚款,有违法所得的,没收

违法所得：……(四)经营保税货物的运输、储存、加工、装配、寄售、展示等业务，不依照规定办理收存、交付、结转、核销等手续，或者中止、延长、变更、转让有关合同不依照规定向海关办理手续的；……。”

广东气派上述外发加工保税货物未依照规定办理海关手续的行为构成违反海关监管规定行为，鉴于广东气派已收回全部外发加工保税货物，东莞海关决定对广东气派上述外发加工保税货物不依照规定办理海关手续的行为作出如下行政处罚：减轻处罚，罚款 39.10 万元。

2023 年 7 月 17 日，东莞太平海关对前述行政处罚出具说明如下：广东气派上述行为构成违反海关监管规定，但不存在主观故意、非重大违规事项，违法情节轻微。

②截至 2022 年 5 月 6 日，广东气派在执行 E5204B0A1129 号电子账册期间，存在短少保税料件未封装芯片的情形，短少保税料件货物价值 321.22 万元。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第三项规定：“有下列行为之一的，处货物价值 5%以上 30%以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：……（三）经营海关监管货物的运输、储存、加工、装配、寄售、展示等业务，有关货物灭失、数量短少或者记录不真实，不能提供正当理由的；……。”

根据前述规定，广东气派短少保税料件的行为违反了海关监管规定，东莞海关决定对该等行为处罚款 16.10 万元。

2023 年 7 月 17 日，东莞太平海关对前述行政处罚出具说明如下：广东气派上述行为构成违反海关监管规定，但不存在主观故意、非重大违规事项，违法情节轻微。

广东气派该项行政处罚情形不存在主观故意，在发现该事项后及时进行了整改，由海关减轻处罚，并出具说明确认违法情节轻微，不构成重大违法违规事项。

2、税务处罚

2025 年 4 月 11 日，惠州气派收到博罗县税务局第一税务分局《责令限期改正通知书》（博一分局税限改[2025]5849 号），惠州气派因个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报。惠州气派因该事项被税务部门罚款 50.00 元。本次行

政处罚金额较小，不构成重大违法违规事项。

除前述行政处罚情形外，报告期内，公司及子公司不存在其他行政处罚情形。

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资的认定标准

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》一、关于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用：“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。”

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-1 条：“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等”。

（二）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）

本次发行预案的董事会决议日为第五届董事会第六次会议决议日（2026 年 4 月 27 日）。自本次发行董事会决议日前六个月（2025 年 10 月 28 日）至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施的、类金融、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务。因此，自本次发行

相关董事会前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况。

综上，本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。

（三）最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形

截至2026年3月31日，公司主要可能涉及财务性投资的科目情况如下：

序号	项目	账面金额（万元）	是否属于财务性投资
1	货币资金	8,338.70	否
2	应收款项融资	1,964.51	否
3	其他应收款	1,484.39	否
4	其他流动资产	1,479.64	否
5	长期股权投资	239.41	否
6	其他非流动资产	37.42	否

1、货币资金

截至2026年3月31日，公司货币资金账面金额为8,338.70万元，主要为银行存款和其他货币资金，不属于财务性投资。

2、应收款项融资

截至2026年3月31日，公司应收款项融资账面金额为1,964.51万元，主要为收到的银行承兑汇票，不属于财务性投资。

3、其他应收款

截至2026年3月31日，公司其他应收款账面金额为1,484.39万元，主要为保证金及押金，不属于财务性投资。

4、其他流动资产

截至2026年3月31日，公司其他流动资产账面金额为1,479.64万元，主要为待抵扣增值税进项税金，不属于财务性投资。

5、长期股权投资

截至2026年3月31日，公司长期股权投资账面金额为239.41万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被投资单位	期末账面价值	期末持股比例	是否存在关联关系	是否控制该公司
1	东莞市芯源集成电路科技发展有限公司	239.41	10.00%	是	否

东莞市芯源集成电路科技发展有限公司是公司联合电子科技大学广东电子信息工程研究院等多个单位合资成立的集成电路试验基地，定位于建设集成电路设计原型验证平台、公共技术服务平台和制造中试基地，属于公司现有业务的延伸，故公司投资东莞市芯源集成电路科技发展有限公司属于“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资”，不属于财务性投资，不属于类金融业务。

6、其他非流动资产

截至2026年3月31日，公司其他非流动资产账面金额为37.42万元，主要为预付长期资产购置款，不属于财务性投资。

7、其他权益工具投资

截至2026年3月31日，发行人其他权益工具投资账面价值为0元，不存在财务性投资。

8、其他债权投资、发放贷款和垫款

截至2026年3月31日，发行人其他债权投资、发放贷款和垫款账面价值均为0元，不存在其他债权投资、发放贷款和垫款，不存在财务性投资。

9、借予他人款项

截至2026年3月31日，发行人未向合并报表范围以外的第三方借予款项。

10、委托理财

截至2026年3月31日，发行人未持有委托理财产品。

11、类金融、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务

截至 2026 年 3 月 31 日，发行人不存在投资类金融、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等财务性投资的情形。

八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施

（一）科技创新水平

公司始终以客户需求为导向，持续深化封装测试领域的技术研发与创新应用。自成立以来，公司高度重视研发创新工作和技术积累。报告期末，公司共取得国内外专利 322 项，被认定为国家高新技术企业、广东省制造业单项冠军企业等，广东气派被评为国家级专精特新“小巨人”企业、广东省省级企业技术中心，上述资质和荣誉体现了公司在封装测试领域的持续创新能力与行业认可度。

公司具备较强的技术研发与创新转化能力，能够为客户提供高可靠性、定制化的封装测试整体解决方案。公司产品功能已覆盖功率管理、信号处理、射频通信、传感检测及系统级封装集成等多个技术模块，广泛应用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制及汽车电子等领域，在封装测试领域形成了稳定的技术积累，同时在晶圆测试等相关环节具备一定的技术基础。

封装测试行业是集成电路产业链的关键环节之一，其技术创新主要体现在封装工艺的结构设计优化与制造过程创新。公司深耕芯片封装测试领域近二十年，通过自主开发的高精度引线键合工艺、激光开槽技术、通用治具平台以及多排矩阵成型模具等技术手段，持续提升产品一致性与生产效率，逐步形成了具有自主特色的封装技术体系。公司现已具备从标准封装到先进封装的完整产品线，主要产品包括 SOP、SOT、QFN/DFN、LQFP、CPC 等多个系列，累计超过 300 个品种。

综合来看，公司凭借在封装技术研发、生产工艺创新及客户协同开发等方面的持续投入，已在国内封装测试市场形成较强的综合竞争力，充分体现了公司的

技术实力和科技创新水平。

（二）保持科技创新能力的机制和措施

1、完善的研发体系

公司始终将自主创新和持续研发作为战略目标和基本要求，建立了规范和完善的研发流程管理制度。公司产品的研发始终以客户需求和行业发展趋势为导向，将客户需求和市场趋势充分结合，经过申报评审、研发立项、需求分析与确认、开发过程、项目验收、产品维护等研发步骤，形成研发成果。在此过程中，公司各业务板块应用研发部门、公司研发中心分工协调，各专业岗位技术人员职责明确。在新品研发过程中，公司凭借多年的研发管理经验和技术积累，依照产品的创新性、功能性以及客户需求、行业趋势制定不同的产品研发策略，以保证新品开发、产品升级契合市场需求。

2、持续的研发投入

公司始终坚持技术研发投入，以期实现技术迭代创新。报告期内，公司在研发方面保持持续的研发投入，研发费用分别为 4,696.39 万元、5,057.25 万元、5,175.55 万元和 1,317.11 万元。研发费用的不断投入，使得公司不断涌现技术创新人才，为公司的长远发展夯实技术基础。

3、激励机制

公司始终坚持人才发展与激励战略并行的策略，有利于提高技术人员的积极性，形成以先进技术成果为导向的激励机制。2021 年，公司对 9 名激励对象设立员工持股计划参与 IPO 新股发行的战略配售；2023 年，公司实施了员工持股计划和限制性股票激励计划。后续几年，公司将持续推进以短期激励与长期股权激励相结合的人才激励措施，稳定公司核心人才队伍，服务公司产品研发与业务管理，提升公司核心竞争力。

九、上市以来的重大资产重组情况

公司上市以来，未进行重大资产重组。

十、境外经营情况

截至本募集说明书出具日，公司在中国香港特别行政区拥有 1 家子公司气派科技（香港）有限公司，其基本情况如下：

公司名称	气派科技（香港）有限公司
商业登记号码	74378495
公司董事	庞琳铃
注册资本	1 万美元
成立日期	2022 年 8 月 30 日
住所	RM 1702 SINO CTR, 582-592 NATHAN RD MONGKOK, KLN, HONG KONG
经营范围	集成电路贸易
股权结构	发行人持股 100%

气派香港最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	1,270.01	1,878.43
净资产	108.66	38.53
营业收入	533.33	2,145.56
净利润	71.03	-19.07

十一、规范运作情况

（一）公司基本规范运作情况

公司已按照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》及其他相关法律法规制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关制度，并得到有效执行。

公司股东会、董事会的通知、召开方式、表决方式和决议内容等符合现行有关法律法规以及公司的规章制度，股东会、董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

公司的独立董事依据有关法律法规及公司的规章制度，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行权利和义务。在公司董事会做出重大决策前，公司能够向独立董事提供足够的材料，充分听取独立董事的意见，独立董事积极参与公司决策，发挥了其在财务、战略决策等方面的专业特长，对于促进规范运作、谨慎把握募集资金

投资项目的选择、日常经营管理及发展战略的确定均起到了良好的作用，维护了全体股东的利益。

公司最近三个会计年度的财务报告已经天职国际审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，确认公司财务报表已在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

天职国际为公司财务报表相关的内部控制有效性出具了内部控制审计报告，认为气派科技于 2023 年末、2024 年末和 2025 年末按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

截至本募集说明书出具日，公司不存在以下情况：

1、现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

2、公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

3、公司控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

根据市场监督、社会保障、应急管理等相关主管部门出具的证明，以及网络检索结果，公司最近三年不存在重大违法违规行为。

公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情况。

（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况

1、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经核实，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

2、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

经核实，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次以简易程序向特定对象发行股票的背景

1、国家行业规划及产业政策的大力支持

半导体产业是支撑国民经济发展与国防安全的战略性、基础性、先导性产业，直接关乎国家产业链供应链自主可控与核心竞争力。在全球科技竞争日趋激烈的大背景下，我国陆续出台一系列扶持政策，从研发投入、税收优惠、人才引育、产业链协同等多维度给予全方位支持，引导产业高质量发展，全力鼓励突破核心技术瓶颈，摆脱高端芯片及配套环节对外依赖的局面。

2026 年 3 月，全国两会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，提出加强原始创新和关键核心技术攻关，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。2025 年 3 月，国家发展改革委、工业和信息化部等多部门发布的《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》提出，延续并优化集成电路产业税收优惠政策。2024 年 5 月，中央网信办等三部门联合发布的《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》提出，围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。

2、半导体行业景气度全面复苏与国产替代驱动半导体封测市场发展

半导体行业呈现“强周期性”，每 3-5 年经历一轮“需求爆发-产能扩张-库存调整-复苏”的循环。历经行业周期调整后，全球半导体行业迎来全面复苏拐点，下游终端市场需求持续回暖，存储芯片、逻辑芯片、功率器件等核心产品出货量稳步攀升，上游设计与制造环节产能持续释放，直接带动后端封装测试需求快速增长，行业景气度持续上行。从全球市场来看，半导体厂商纷纷扩大资本开支，新增产能逐步落地，封测环节产能利用率持续提升，部分先进封测产能甚至出现供

需偏紧态势，行业整体营收与利润规模同步回暖，为封测产业发展营造了良好的市场环境。

随着全球贸易摩擦和技术封锁加剧，我国半导体产业的部分关键核心技术领域仍面临“卡脖子”困境，对外依存度较高。近年来我国大力推动半导体产业链自主可控，国产替代已从“可选项”变为“必选项”。在政策引导与市场需求双重推动下，本土封测企业技术突破步伐加快，封装测试领域国产化率持续提升。在半导体行业景气度全面复苏与国产替代的驱动下，我国半导体封测产业将迎来良好的发展机遇期。

3、新兴应用领域为半导体封装测试产业发展注入了新的增长动力

集成电路作为各类电子设备的核心部件，下游应用场景持续拓宽，传统消费电子、电力电子、通信设备、医疗电子、航空航天等领域需求保持波动增长趋势。而物联网、人工智能、云计算、大数据、5G 通信、工业机器人、新能源汽车等新兴应用领域的蓬勃发展，进一步催生了高性能、低功耗、小型化、高集成度的芯片需求，为集成电路产业注入了强劲的新增长动能。

封装测试是半导体产业链的核心关键环节，承担着芯片电路连接、结构保护、性能优化及功能验证的重要作用，直接影响集成电路产品的可靠性、稳定性与实际应用效能，是芯片从晶圆走向终端应用的重要环节，其技术水平与产业规模直接关联集成电路产业的整体竞争力。集成电路产业的整体迭代升级、技术突破以及应用领域的不断拓宽，也会反向推动封测产业同步革新，推动封测产业的进一步发展。

4、本次发行符合公司发展战略

公司一直致力于半导体封装测试相关技术的研发创新并不断加强研发投入，掌握了多项核心技术。公司将根据行业未来发展趋势及技术发展方向，加强对新兴领域的研发投入，持续对功率半导体和先进封装方面投入研发，开发更多品类功率半导体封装和先进封装技术，为公司产品丰富提供有力的技术支撑。

本次发行股票有助于提升公司 QFN/DFN、FC-QFN/DFN、LQFP 等中高端产品产能，从而有助于抓住市场机遇，在满足市场需求快速增长的同时，提升上市公司盈利能力。

（二）本次以简易程序向特定对象发行股票的目的

1、突破产能瓶颈，满足下游市场需求

半导体封装测试行业在技术进步、下游应用领域不断拓展以及国产替代等多因素驱动下，迎来良好的发展机遇期。其一，半导体产品在集成度、性能、功耗及可靠性等方面的要求持续提升，对封装测试环节的精度控制、工艺复杂度与规模化生产能力提出更高标准。其二，人工智能、汽车电子、高性能计算、物联网等新兴应用场景快速崛起，带动高可靠性、高定制化封装测试产品的需求持续增长。其三，随着国产半导体产业替代进程加速，本土封装测试企业迎来重要发展契机。

公司深耕半导体封装测试领域多年，已发展成为华南地区规模领先的内资封装测试企业之一。近年来，公司业务规模稳步扩张，产能利用率持续攀升。2023年至2025年，公司封装测试产能利用率分别为68.13%、80.57%、88.52%，2025年全年处于较高负荷运行状态。现有产能接近饱和已成为制约订单承接与业务扩张的重要因素。若无法及时扩充产能，公司将面临订单交付延迟、客户流失等风险，错失行业发展机遇，进而影响营收规模扩大与市场份额提升。本次扩产项目通过新增封装测试产能，可有效释放产能瓶颈，满足下游市场需求，提升公司可持续发展能力。

2、扩大经营规模，巩固和提升行业竞争地位

当前，国内封装测试市场竞争格局日趋激烈，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金扩充产能、进行技术和产品升级，还通过市场化收购兼并实现资源整合与跨越式发展，不断筑牢竞争优势。与此同时，各类外资及合资封测企业也持续加大在中国大陆的产能布局与资金投入，进一步加剧了国内市场的竞争烈度，行业头部集聚效应愈发明显。

公司经过在封测领域多年的积累和拓展，目前已具备一定规模和较强技术实力，但与长电科技、通富微电和华天科技等为典型代表的中国大陆封装测试行业龙头企业相比，仍有较大的提升空间。在当前市场高速发展的态势下，公司如若不能及时扩大自身规模、增强竞争实力，将可能面临市场份额被挤压、客户资源流失的风险。特别是随着下游客户对供应链稳定性和交付能力的要求不断提高，

产能规模已成为客户选择封测供应商的重要考量因素。因此，通过本项目建设扩大生产规模，是公司巩固和提升市场竞争地位的必然选择。

3、优化产品结构，提高先进封装产品占比

近年来，集成电路终端系统向多任务处理、微型化方向加速演进，持续驱动封装技术向高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化及小型化迭代升级。在此背景下，FC、SiP、TSV 等先进封装技术的应用场景不断拓展，已成为行业重要发展方向。

当前，日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面地掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，并实现规模化应用。而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，先进封装产品占比相对较低。因此，公司若不能及时强化先进封装领域的产能布局，将难以匹配下游终端市场对先进封装的需求，可能导致核心竞争力弱化、市场份额被挤压，进而面临市场空间持续收窄的风险。基于此，公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措。本项目建设完成后，将有效提升公司 FC 等先进封装产品的产能布局，助力产品结构优化升级。

二、发行对象及与公司的关系

（一）发行对象的基本情况

本次发行对象均通过竞价方式确定，发行对象共 8 名，分别为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。

根据公司与前述发行对象分别签署的《气派科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，本次发行的发行对象均已承诺其用于认购本次发行的全部资金来源符合中国适用法律的要求；发行对象参与本次发行的认购资金来源为自有资金或依法募集的资金，不存在代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在公司及其

控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（二）发行对象与公司的关系

本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）定价方式和发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2026 年 7 月 1 日）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 37.79 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。

（二）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次发行拟发行股票数量为 2,910,822 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整，调整公式为：

$$Q_1=Q_0\times(1+n)$$

其中：Q₀为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q₁为调整后的本次发行股票数量。

（三）限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。因公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

四、募集资金金额及投向

本次发行拟募集资金总额为 11,000.00 万元，扣除发行费用后净额全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设，系围绕公司主营业务展开。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。

上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

公司控股股东为梁大钟先生，实际控制人为梁大钟、白瑛、梁华特。截至本募集说明书出具日，梁大钟先生直接持有公司 40.37%的股份，白瑛女士直接持有公司 10.49%的股份，梁华特先生直接持有公司 5.51%的股份，三人合计持有公司 56.37%的股份。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，梁大钟、白瑛、梁华特持有股份占公司总股本的比例将有所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件

（一）《公司法》和《证券法》的相关规定

1、发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定

发行人本次以简易程序向特定对象发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和发行价格均相同，所有认购对象均以相同价格认购，符合该条“同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”的相关规定。发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定。

2、发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的相关规定

根据本次发行的竞价结果，本次发行价格为 37.79 元/股。发行价格超过票面金额，符合该条“股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额”的相关规定。发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的相关规定。

3、发行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的相关规定

发行人就本次以简易程序向特定对象发行股票事项履行了以下决策程序：

（1）2026 年 4 月 23 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式和发行对象、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

(2) 2026 年 4 月 27 日, 根据 2025 年年度股东大会的授权, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等议案及相关事宜。

(3) 2026 年 5 月 14 日, 公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年(2026-2028 年) 股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。

(4) 2026 年 7 月 10 日, 根据 2025 年年度股东大会的授权, 公司召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了本次发行竞价结果和发行方案修订等相关事宜。

综上, 发行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的相关规定。

4、发行人本次发行符合《证券法》第九条的相关规定

发行人本次发行, 未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式, 符合该条“向特定对象发行证券, 不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式”的相关规定。

发行人本次发行符合《证券法》第九条的相关规定。

(二) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

1、截至 2026 年 3 月末, 公司不存在金额较大的财务性投资的情形, 符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一项规定。

2、公司及主要股东最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为, 符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二项的规定。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行系以简易程序向特定对象发行股票, 不适用于再融资时间间隔的规定。公司未实施重大资产重组, 控股股东、实际控制人的控制结构未发生变化。本次发行符合“理性融资, 合理确定融资规模”的要求, 符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四项的规定。

4、本次发行募集资金总额为 11,000.00 万元, 扣除发行费用后净额全部用于公司“高密度高性能芯片封测项目”建设, 符合“用于补充流动资金和偿还债务

的比例不得超过募集资金总额的百分之三十”的规定，符合《证券期货法律适用意见第18号》第五项规定。

（三）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定

1、本次发行符合《注册管理办法》第十一条的规定

公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的下述不得向特定对象发行股票的情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、本次发行符合《注册管理办法》第十二条的相关规定

本次发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，扣除发行费用后净额全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

公司本次发行募集资金使用符合下列规定：“（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（二）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；（四）科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。”

3、本次发行符合《注册管理办法》第二十一条及第二十八条关于适用简易程序的规定

公司 2025 年年度股东会已就本次以简易程序向特定对象发行的相关事项作出了决议，并授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。

根据 2025 年年度股东会授权，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行有关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

根据上述审议，本次发行的认购对象认购金额合计 11,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第二十一条及第二十八条的相关规定。

4、发行人本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的相关规定

本次发行对象共 8 名，分别为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金，不超过三十五名特定发行对象。本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的相关规定。

5、发行人本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条和第五十八条的相关规定

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2026 年 7 月 1 日），发行价格为 37.79 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的相关规定。

6、发行人本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的相关规定

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及交易所的有关规定执行。发行人本次发行限售期安排符合《注册管理办法》第五十九条的相关规定。

7、发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的相关规定

《注册管理办法》第六十六条规定：“向特定对象发行证券，上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不得直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。”

公司披露了《气派科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告》，本次发行，上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。发行人本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的相关规定。

8、本次发行符合《注册管理办法》第八十七条之规定

本次发行完成后，公司股本将相应增加，梁大钟、白瑛、梁华特持有股份占公司总股本的比例将有所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的经营管理产生不利影响，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

（四）本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“上市审核规则”）的相关规定

1、发行人本次发行不存在《上市审核规则》第三十四条规定的不得适用简易程序的情形

发行人本次发行不存在《上市审核规则》第三十四条规定的不得适用简易程序的情形：

“（一）上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示；

（二）上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分；

（三）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理，在非行政许可事项中提供服务的行为，不视为同类业务。”

2、本次发行符合《上市审核规则》第三十五条的相关规定

本次发行符合《上市审核规则》第三十五条关于适用简易程序的相关规定：

“上市公司及其保荐人应当在上市公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向本所提交下列发行上市申请文件：

（一）募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东会决议、经股东会授权的董事会决议等注册申请文件；

（二）上市保荐书；

（三）与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

（四）中国证监会或者本所要求的其他文件。

上市公司及其保荐人未在前款规定的时限内提交发行上市申请文件的，不再适用简易程序。

上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人应当在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确核查意见。”

2026年4月27日，根据2025年年度股东大会的授权，公司第五届董事会第六次会议审议通过了本次发行方案及其他相关事宜。

2026年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次发行竞价结果和发行方案修订及其他发行相关事宜。

保荐机构提交申请文件的时间在发行人年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。发行人及其保荐人提交的申请文件包括：①募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东会决议、经股东会授权的董事会决议等申请文件；②上市保荐书；③与发行对象签订的附条件生效股份认购合同；④中国证监会或者上交所要求的其他文件。

发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规范性文件关于科创板以简易程序向特定对象发行的相关要求。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已在本次发行募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐机构已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行方案已取得的授权和批准

2026年4月23日，公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2026年4月27日，根据2025年年度股东大会的授权，公司第五届董事会第六次会议审议通过了本次发行方案及其他相关事宜。

2026年7月10日，根据2025年年度股东大会的授权，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次发行竞价结果和发行方案修订等相关事宜。

（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序

本次发行相关事项尚需经上交所审核并报中国证监会履行注册程序。

十、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”

（一）本次发行符合国家产业政策及板块定位

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为11,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设，系围绕公司主营业务展开。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业，为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的鼓励类产业，不属于产能过剩行业，不属于限制类、淘汰类行业，亦不属于高耗能、高排放行业，符合国家产业政策；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路制造。因此，本次募集资金投向所处行业属于科技创新领域。

综上，本次发行符合国家产业政策及科创板板块定位。

（二）本次发行不涉及“四重大”

公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、需要审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索。因此，本次发行不涉及“四重大”情形。

综上，本次发行满足“两符合”的相关规定，不涉及“四重大”的相关情形。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，扣除发行费用后净额全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设。若本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金的必要性、可行性分析

公司本次发行股票，拟使用募集资金 11,000.00 万元，扣除发行费用后净额将用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资额
1	高密度高性能芯片封测项目	19,812.39	11,000.00
合计		19,812.39	11,000.00

高密度高性能芯片封测项目建设地点位于东莞市石排镇气派科技路 1 号，拟利用现有厂房并装修改造实施，并配备相应的生产设备，扩大公司封装测试产能。本项目建设完成后，公司将新增 QFN/DFN、DFN（第三代半导体：氮化镓、碳化硅）、FC-QFN/DFN、LQFP 等封装测试产能 5.14 亿只/年。项目的建设有利于进一步扩大公司产能，并优化公司产品结构，强化公司竞争力。

本项目计划投资总额 19,812.39 万元，其中，建设投资 19,575.37 万元，铺底流动资金 237.02 万元。

（一）募集资金的必要性分析

1、半导体行业需求持续攀升

近年来，5G 技术、物联网、新能源汽车及人工智能等新兴技术与终端产品加速迭代普及，直接带动全球半导体市场需求持续攀升，行业整体进入高速增长阶段。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2023 年全球半导体市场规模从 2022 年创历史新高的 5,741 亿美元下降 8.22%，至 5,269 亿美元；2024 年

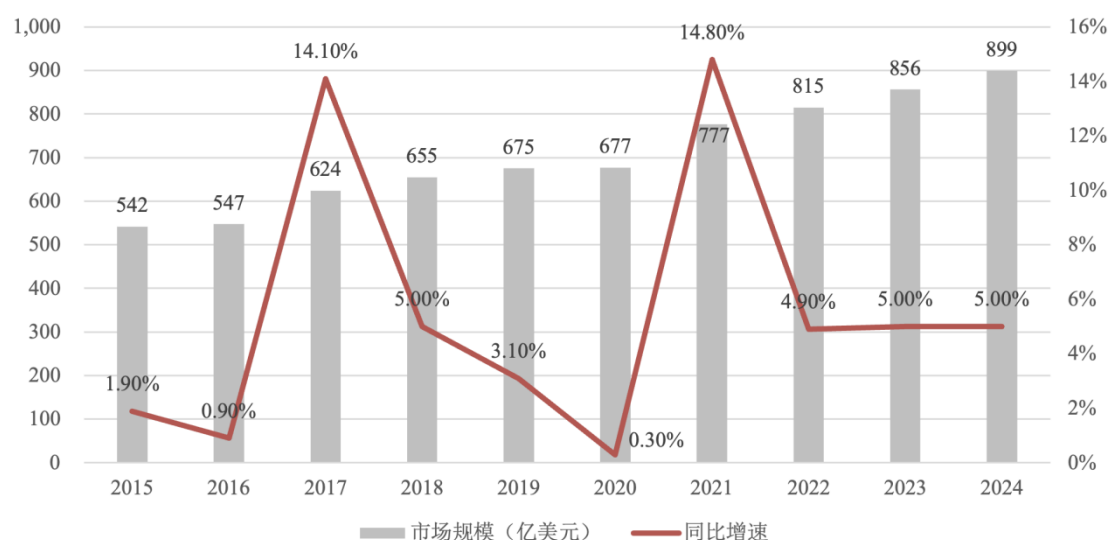
全球半导体市场规模同比增长 19.67%，至 6,305 亿美元。2025 年全球半导体市场规模同比增长 26.18%，至 7,956 亿美元，创下历史最高的年销售额，2026 年市场规模预计将继续增长。



数据来源：WSTS

半导体市场规模的持续增长带动集成电路封测市场需求持续攀升，根据 Yole 的相关数据，2014 年至 2024 年，全球半导体封装测试市场销售额由 532 亿美元增长至 899 亿美元。未来，全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好，2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元。

2015-2024 年全球半导体封装测试市场销售额及增长情况



数据来源：Yole

2、突破产能瓶颈，满足下游市场需求

公司深耕半导体封装测试领域多年，已发展成为华南地区规模领先的内资封装测试企业之一。近年来，公司业务规模稳步扩张，产能利用率持续攀升。2023年至2025年，公司封装测试产量分别为89.74亿只、107.98亿只、119.34亿只，对应收入分别为5.20亿元、6.24亿元、7.29亿元，增速分别为19.91%和16.83%，封装测试产品和收入均保持较快增长。2023年至2025年，公司封装测试产能利用率分别为68.13%、80.57%、88.52%，2025年全年处于高负荷运行状态。公司现有产能接近饱和已成为制约订单承接与业务扩张的重要因素。若无法及时扩充产能，公司将面临订单交付延迟、客户流失等风险，错失行业发展机遇，进而影响营收规模扩大与市场份额提升。

本次扩产项目公司产品系DFN/QFN等系列的中高端产品，应用领域包括人工智能、物联网、智能家居、消费电子等高景气高需求行业，可有效释放产能瓶颈，满足下游市场需求，提升公司可持续发展能力。

3、布局 FC 先进封装形式产品，优化产品结构，提升公司在先进封装测试领域的竞争力

近年来，集成电路终端系统向多任务处理、微型化方向加速演进，持续驱动封装技术向高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化及小型化迭代升级。在此背景下，FC、SiP、TSV等先进封装技术的应用场景不断拓展，已成为行业重要

发展方向。

当前，日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面地掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，并实现规模化应用。而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，先进封装产品占比相对较低。因此，公司若不能及时强化先进封装领域的产能布局，将难以匹配下游终端市场对先进封装的需求，可能导致核心竞争力弱化、市场份额被挤压，进而面临市场空间持续收窄的风险。基于此，公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措。本项目建设完成后，将有效提升公司 FC 等先进封装产品的产能布局，助力产品结构优化升级，提升公司在先进封装测试领域的竞争力。

4、扩大经营规模，巩固和提升行业竞争地位

当前，国内封装测试市场竞争格局日趋激烈，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金扩充产能、进行技术和产品升级，还通过市场化收购兼并实现资源整合与跨越式发展，不断筑牢竞争优势。与此同时，各类外资及合资封测企业也持续加大在中国大陆的产能布局与资金投入，进一步加剧了国内市场的竞争烈度，行业头部集聚效应愈发明显。

公司经过在封测领域多年的积累和拓展，目前已具备一定规模和较强技术实力，但与长电科技、通富微电和华天科技等为典型代表的中国大陆封装测试行业龙头企业相比，仍有较大的提升空间。在当前市场高速发展的态势下，公司如若不能及时扩大自身规模、增强竞争实力，将可能面临市场份额被挤压、客户资源流失的风险。特别是随着下游客户对供应链稳定性和交付能力的要求不断提高，产能规模已成为客户选择封测供应商的重要考量因素。因此，通过本项目建设扩大生产规模，是公司巩固和提升市场竞争地位的必然选择。

（二）募集资金的可行性分析

1、本项目产品具有广阔的市场前景

半导体封测产业与半导体产业景气状况紧密相关，随着半导体景气度全面复苏以及人工智能、数据中心、云计算、物联网、虚拟/增强现实等新兴应用场景的快速发展，全球半导体产业景气度高涨带动半导体封测市场规模持续扩张。根据

Yole 的相关数据，2014-2024 年，集成电路封装测试全球市场规模由 532 亿美元增长至 899 亿美元，复合年增长率（CAGR）达到 5.4%。

根据中国半导体行业协会的数据，从中国大陆市场来看，受益于产业政策支持与下游需求带动，2017-2024 年中国大陆封测市场规模由 1,889.7 亿元增长至 3,336.8 亿元，复合增长率为 8.5%；未来随着全球集成电路产业重心向中国大陆转移，行业将保持稳定增长态势。

综上所述，半导体封测产业广阔的市场空间是本项目的建设基础，项目产品符合行业发展趋势和市场需求，具有良好的市场前景。

2、公司具备的生产组织与质量管理优势为项目产品提供基础保障

封装工艺的功能包括功率分配（电源分配）、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等，每一项功能都能影响芯片的性能，封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的 PCB（印制电路板）的设计和制造。因此，良好的生产组织与质量管控能力，是封测企业重要的竞争力之一。

公司深耕半导体封测领域多年，积累了丰富的产品矩阵与工艺经验，封装产品覆盖 MEMS、FC、CPC、SOP 等多种系列。公司自成立伊始便坚持提升生产管理与质量管理水平，打造了一支经验丰富的研发技术团队和高素质生产管理团队。在生产组织方面，公司依托成熟的生产经验与稳定可靠的技术工艺，采用柔性化生产模式，可根据客户订单需求灵活调整生产计划与产品结构，快速完成生产线调试与组合，实现高效率、多批次、小批量的柔性生产，显著提升市场快速响应能力。此外，公司建立并严格执行全流程质量管理体系，不断完善作业规范、质量控制及工艺管理制度，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系及 ISO22301 业务连续性管理体系认证等，为产品质量稳定与持续经营提供坚实保障。

3、公司具备的技术和人才优势为项目提供技术基础

本次募投项目产品均已正式量产或小批量试生产，募投项目实施具备技术基础。

半导体封装测试行业属于技术密集型与人才密集型行业，管理团队与核心技

术团队是企业持续技术创新、保持核心竞争力的关键要素。封装测试企业需要能够将理论研究与实际生产相结合的专业性人才，才能更好地提升公司的技术水平、研发能力和生产管理能力和，保证生产效率、产品成本与质量、交货期的稳定性，形成竞争优势。

公司专注于半导体封装测试领域，经过多年技术积累与市场深耕，已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，也是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。在人才方面，公司核心技术人员具备多年半导体封测行业从业经验，研发团队熟练掌握半导体封装特性及封装测试生产流程关键技术，有效保障公司产品在质量稳定性、成本控制、规模化交付等方面形成核心竞争优势。目前公司已掌握了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

综上，公司具有的技术和人才优势助力公司在国内半导体封测领域构建较强的综合竞争实力，为项目顺利实施奠定了扎实的技术和人才基础。

4、项目概算

本项目总投资 19,812.39 万元，具体构成情况如下：

序号	费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	19,575.37	98.80%
1.1	建筑工程费	660.00	3.33%
1.1.1	装修工程费	660.00	3.33%
1.2	设备购置及安装费	17,983.21	90.77%
1.3	预备费	932.16	4.70%
2	铺底流动资金	237.02	1.20%
3	项目总投资	19,812.39	100.00%

5、项目实施主体、建设地点、建设周期

本募投项目实施主体为广东气派科技有限公司，项目建设地点位于广东省东

莞市石排镇气派科技路 1 号，项目建设期为 3 年。

6、项目备案与环境保护评估情况

本项目拟利用现有厂房，不涉及新征土地。本项目已完成备案手续，并于 2026 年 4 月 28 日取得东莞市工业和信息化局出具的《广东省技术改造投资项目备案证》（备案证编号：261027397333437）。本项目于 2026 年 6 月 12 日取得东莞市生态环境局《关于高密度高性能芯片封测项目环境影响报告表的批复》（东环建[2026]1707 号）。

7、项目的效益分析

发行人本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设。项目产品产能规划将在 T+3 实现满产，满产后 DFN/QFN 中高端产品产能为 5.14 亿只。

本次募投项目收入主要参考公司 2025 年同类型产品价格进行测算。成本费用主要参考近两年的公司成本水平以及市场有关价格水平测算，其中生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用；期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用。

本项目为公司主营业务的中高端产品的扩产项目，产品增值税率以 13% 计算；城市维护建设税按增值税额的 5% 计算；教育费附加按增值税额的 3% 计算；地方教育费附加按增值税额的 2% 计算；企业所得税按照 15% 计算。

折旧摊销中，本募投项目涉及的房屋及建筑物、土地使用权按照 50 年折旧摊销，生产设备按照 10 年折旧，办公设备、软件及运输设备均按照 5 年折旧摊销。

经测算，本项目预计税后内部收益率为 10.05%，税后静态投资回收期为 8.54 年，项目经济效益良好，预计未来满产年份为公司增加年营业收入 13,292.00 万元。本项目效益测算充分结合公司实际情况、发展趋势等，审慎确定测算参数，预计效益测算过程及结果具备合理性。

三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

公司主要从事半导体封装测试业务，经过多年的沉淀和积累，已在半导体封装测试领域形成了较为丰富的产品体系、稳定的生产管理能力和一定的工艺创新能力。公司始终坚持以自主创新驱动发展，注重半导体封装测试技术的研发创新，已掌握 5G MIMO 基站 GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案等多项核心技术，具备实施本次募集资金投资项目所需的技术基础和产业化经验。

本次募集资金投资项目“高密度高性能芯片封测项目”围绕公司主营业务开展，拟利用现有厂房并装修改造实施，配备相应生产设备，进一步提升 QFN/DFN、DFN（第三代半导体：氮化镓、碳化硅）、FC-QFN/DFN、LQFP 等中高端封装测试产品的产能规模和交付能力。公司在人员、技术、生产管理、质量控制及市场客户等方面均具备较好的实施基础，能够为本次募投项目顺利建设和后续产能释放提供支撑。

1、人员储备

公司长期深耕半导体封装测试领域，已建立覆盖研发、工艺、生产、测试、质量控制、设备维护及市场拓展等环节的专业团队。经过多年的业务积累，公司核心管理人员和技术骨干对行业发展趋势、客户需求、产品工艺及生产组织具有较为深入的理解，能够较好支撑本次募投项目建设、设备导入、工艺调试、量产爬坡及客户导入等工作。未来，公司将根据项目建设进度和产能释放情况，进一步优化人员配置，适时补充生产、工艺、设备、质量及市场等相关岗位人员，为本次募投项目顺利实施提供人员保障。

2、技术储备

公司自成立以来始终专注于集成电路封装、测试业务，坚持以自主创新驱动发展，持续推进封装测试技术研发创新和工艺积累。公司已掌握 5G MIMO 基站 GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案等多项核心技术，并已开发形成 Qipai、CPC 和 CDFN/CQFN 系列量产产品。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有国内外专利技术 322 项，其中发明专利 56 项。

本次募投项目建设内容与公司现有主营业务、产品体系及技术积累高度相关，公司现有技术储备能够支持项目在设备选型、工艺调试、产品验证、质量控制及

量产导入等方面的实施需求，为本次募投项目顺利实施提供技术支撑。

3、市场储备

公司半导体封装测试产品广泛应用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域。经过多年经营，公司已积累了较为稳定的客户基础和市场渠道，并能够根据下游客户对封装形式、产品性能、交付能力及质量稳定性的需求，提供多品种、一站式的封装测试服务。本次募投项目有助于公司进一步优化产品结构、提升订单承接能力和客户服务能力。随着下游应用领域对高密度、高性能、小型化封装测试需求的持续发展，公司现有客户基础、产品应用场景及市场开拓经验将为本次募投项目产能消化提供市场支撑。未来，公司将继续加强与现有客户的合作，并积极拓展新客户、新应用领域，推动本次募投项目产能逐步释放。

（二）资金缺口解决方式

本次募集资金投资项目总投资额为 19,812.39 万元，拟使用募集资金金额为 11,000.00 万元，差额部分将由公司通过自有资金或自筹资金解决。公司将根据项目建设进度和资金需求统筹安排资金投入，确保募投项目顺利实施。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进展情况，以自有资金或自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将按照相关法律法规规定的程序对前期投入资金予以置换。

四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 11,000.00 万元，扣除发行费用后净额全部用于“高密度高性能芯片封测项目”建设，本项目建设完成后，公司将新增 QFN/DFN、DFN（第三代半导体：氮化镓、碳化硅）、FC-QFN/DFN、LQFP 等中高端封装测试产能 5.14 亿只/年，系围绕公司主营业务展开。根据《上

海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司属于第五条规定的“新一代信息技术领域”。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

（二）本次募集资金将促进公司科技创新水平的持续提升

本次发行有助于公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措，提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展并维护股东利益。未来公司将进一步提升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固、扩大自身的竞争优势，强化自身品牌和科创属性。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于高密度高性能芯片封测项目，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司实际控制人梁大钟、白瑛、梁华特持有股份占公司总股本的比例将有所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向 3 号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务不存在关联关系。本次

发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人不存在关联交易情况。

五、最近五年内募集资金运用的基本情况

（一）前次募集资金到位及验资情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股，募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除中介机构及其他发行费用合计人民币 55,542,826.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 338,224,573.85 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 17 日全部到位，天职国际对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的验资报告。

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]79 号）核准，公司于 2026 年 2 月向特定对象发行股票数量 7,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 20.11 元/股，募集资金总额为人民币 158,869,000.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 3,977,419.13 元，实际募集资金净额为人民币 154,891,580.87 元。

该次募集资金到账时间为 2026 年 2 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2026 年 2 月 4 日出具天职业字[2026]3637 号验资报告。

（二）前次募集资金实际使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 34,188.48 万元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支

出后的净额 448.13 万元，节余的募集资金销户转入基本存款账户金额 82.10 万元。公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	33,822.46
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）	448.13
减：高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	32,123.33
减：研发中心（扩建）建设项目	2,065.15
累计使用募集资金金额	34,188.48
节余的募集资金金额	82.10
截至 2026 年 3 月末募集资金专户余额	0.00

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 15,439.16 万元，全部用于补充流动资金，募集资金专户余额为人民币 50.05 万元，剩余资金仍计划补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

发行人前次募投项目的实际效益情况具体如下：

单位：万元

项目名称	承诺效益	最近三年实际效益			2023 年至 2025 年累计实现效益	是否达到预计效益
		2023 年度	2024 年度	2025 年度		
高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	不适用	-2,074.95	-1,541.48	-1,889.19	-5,505.62	否
研发中心（扩建）建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：研发中心（扩建）建设项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益，故无法单独测算效益。

发行人高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目累计实现效益较低，主要原因系公司下游应用产品以消费电子为主，报告期初，以消费电子应

用为主的集成电路市场需求较为疲软，同时，需求的疲软导致行业竞争加剧，封装测试单价有一定程度的回落；此外，公司产能利用率不足导致公司产品单位成本增加，进而拉低了募投项目实现效益。2023 年第四季度起，下游行业市场需求回暖，公司 2024 年营业收入较 2023 年大幅增加，亏损规模收窄，对应的募集资金投资项目 2024 年实现亏损规模收窄。

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金

发行人募集资金补充流动资金未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。

（四）前次募集资金投资项目变更情况

发行人不存在前次募集资金投资项目变更情况。

（五）前次募集资金使用对公司科技创新的作用

1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用对公司科技创新的作用

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目”和“研发中心（扩建）建设项目”，均与公司半导体封装测试主营业务及核心技术密切相关。

“高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目”围绕公司现有封装测试主业开展，主要对应 QFN/DFN、LQFP 等封装产品，应用领域包括消费电子及其配件、信息通讯、工业应用和智能家居等。项目实施有助于公司顺应集成电路封装技术向高密度、高脚位、薄型化、小型化方向发展的趋势，优化产品结构，提升先进集成电路封装测试产品的产业化能力和市场供应能力，增强公司在半导体封装测试领域的综合竞争力。

“研发中心（扩建）建设项目”通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件、引进和培养优秀人才等方式，提升公司的整体研发实力。项目实施有利于改善公司研发软硬件环境，增强公司在先进封装技术、新型封装材料、封装工艺优化、可靠性验证及产品迭代等方面的研发能力，支持公司持续开展新产品、新技术、新工艺研发及现有技术升级改进，巩固和强化公司核心技术优势。

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金使用对公司科技创新的作用

公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，系围绕公司半导体封装测试主营业务展开。公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的“新一代信息技术领域”中的半导体和集成电路相关方向，因此该次募集资金投向属于科技创新领域。

补充流动资金有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，改善公司资本结构，降低财务费用和经营压力，保障公司对研发创新、工艺优化、产品迭代及业务拓展的资金支持，推动公司可持续发展。

综上，公司前次募集资金投资项目均围绕公司主营业务及核心技术开展，是结合国家产业政策、行业发展趋势、市场需求和公司发展战略规划，以既有产品和技术积累为依托实施的投资计划，有助于优化产品结构，完善研发创新平台，增强产品开发、工艺升级和产业化能力，巩固并提升公司核心竞争力。因此，公司前次募集资金实际投向属于科技创新领域。

（六）闲置募集资金的使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

2、2025 年向特定对象发行股票募集资金

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（七）注册会计师对发行人前次募集资金运用所出具的专项报告结论

天职国际对发行人截至 2026 年 3 月末的前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]24987 号），认为：“气派科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了气派科技截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。”

第五节 与本次发行相关的风险因素

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）市场和行业风险

1、宏观经济及下游相关行业波动的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（一）市场和行业风险”之“1、宏观经济及下游相关行业波动的风险”。

2、半导体行业周期性波动的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（一）市场和行业风险”之“2、半导体行业周期性波动的风险”。

3、市场竞争加剧的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（一）市场和行业风险”之“3、市场竞争加剧的风险”。

（二）财务风险

1、净利润持续为负的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“1、净利润持续为负的风险”。

2、毛利率波动风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“2、毛利率波动风险”。

3、应收账款发生坏账风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“3、应收账款发生坏账风险”。

4、存货跌价损失的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“4、存货跌价损失的风险”。

5、净资产收益率和每股收益被摊薄的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“5、净资产收益率和每股收益被摊薄的风险”。

6、流动性风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（二）财务风险”之“6、流动性风险”。

（三）经营风险

1、生产效率下降风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“1、生产效率下降风险”。

2、核心技术人员流失的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“2、核心技术人员流失的风险”。

3、经营规模扩张带来的管理风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“3、经营规模扩张带来的管理风险”。

4、技术风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“4、技术风险”。

5、房屋及土地已抵押的风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“5、房屋及土地已抵押的风险”。

6、行政处罚风险

详见本募集说明书之“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（三）经营风险”之“6、行政处罚风险”。

（四）募投项目新增折旧摊销的风险

详见本募集说明书“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（四）募投项目新增折旧摊销的风险”。

（五）募集资金使用效益未达预期的风险

详见本募集说明书“重大事项提示”之“二、特别风险提示”之“（五）募集资金使用效益未达预期的风险”。

二、审批与发行风险

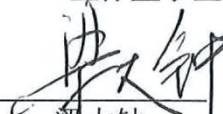
本次股票发行事项已经股东会授权，本次股票发行方案已经公司董事会批准，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定，能否获得相关审批机构的批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。

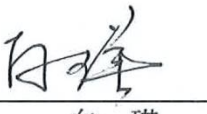
第六节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

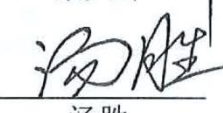
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

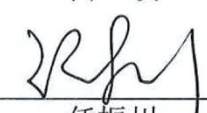
全体董事签字：

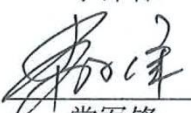

梁大钟


白瑛


李泽伟

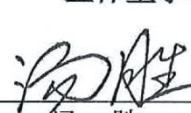

汤胜

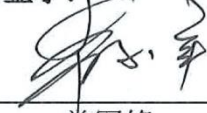

任振川

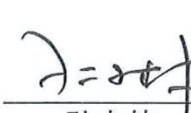

常军锋


孙少林

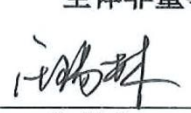
全体董事会审计委员会成员签字：

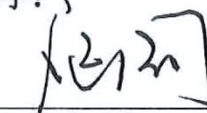

汤胜


常军锋


孙少林

全体非董事高级管理人员签字：


饶锡林


文正国


王荣宝

气派科技股份有限公司

2026年7月15日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签字：


梁大钟


白 瑛


梁华特


气派科技股份有限公司
2026年 7 月 15 日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

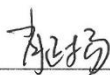


王兆琛



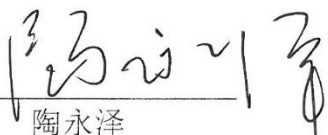
王江

项目协办人：



肖正扬

保荐机构法定代表人、董事长：



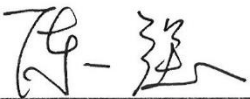
陶永泽



保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读《气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》的全部内容，对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐机构总经理：


陈 强

保荐机构法定代表人、董事长：


陶永泽



2026 年 7 月 15 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师： 支毅 曹倩 郑晓欣
支毅 曹倩 郑晓欣

律师事务所负责人： 朱小辉
朱小辉



五、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、非经常性损益明细表审核报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



扶交亮

已离职
谢才祥

已离职
杨江雄



聂娟



陈子涵

会计师事务所负责人：

邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



六、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺：气派科技股份有限公司本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事签字：



梁大钟



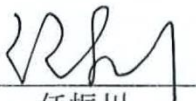
白 瑛



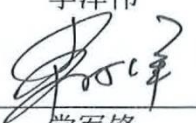
李泽伟



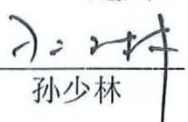
汤胜



任振川

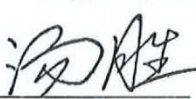


常军锋

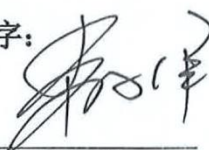


孙少林

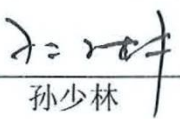
全体董事会审计委员会成员签字：



汤 胜

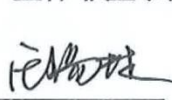


常军锋

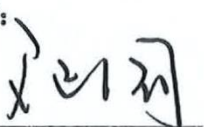


孙少林

全体非董事高级管理人员签字：



饶锡林



文正国



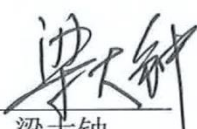
王羊宝

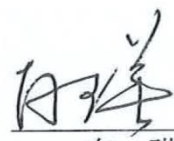


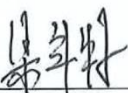
七、发行人控股股东、实际控制人承诺

本公司控股股东及实际控制人承诺：气派科技股份有限公司本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

控股股东、实际控制人签字：


梁大钟


白 瑛


梁华特

气派科技股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

八、发行人董事会声明

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为促进业务健康、良好的发展，充分保护本公司股东特别是中小股东的权益，本公司将采取如下具体措施提高日常运营效率，降低运营成本，增强公司的可持续发展能力，提升本公司的业务规模、经营效益，为中长期的股东价值回报提供保障。公司拟采取如下回报填补措施：

1、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已根据《公司法》《证券法》和《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用，并对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金专款专用，确保募集资金按照既定用途得到有效使用。

2、加快主营业务的拓展，提高公司的竞争力

经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次发行将进一步推进公司主营业务的发展，提高公司的竞争优势、改善公司的资产质量，使公司的资金实力进一步提高，实现公司的稳步健康发展，对公司的生产经营具有积极意义。同时，公司将进一步提高核心技术产品的研发投入并扩大市场竞争优势，提升公司的研发和创新能力，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将科学统筹资金使用，切实提高资金使用效率，助力公司实现稳健发展，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

3、进一步优化经营管理和提升经营效率

本次发行募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积

极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。

4、完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行分红政策，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（此页无正文，为《气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》之发行人董事会声明与承诺之盖章页）

气派科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日

附录

一、专利

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已获得的国内外专利 322 项，其中发明专利 56 项，外观专利 73 项，实用新型专利 193 项，具体如下：

序号	申请人/专利权人	专利申请日	专利号	名称	类型	取得方式
1	气派股份	2011-10-28	ZL201110334691.5	一种高密度集成电路封装结构、封装方法以及集成电路	发明	原始申请
2	气派股份	2012-12-31	ZL201210589083.3	一种提高集成电路封装中键合机台效率的方法	发明	原始申请
3	气派股份	2013-11-6	2013082201	一种基于框架采用键合线连接技术的封装件及其制作工艺	发明	转让
4	气派股份	2015-7-8	ZL201510399162.1	一种高密度集成电路封装结构	发明	原始申请
5	气派股份	2016-1-12	ZL201610017709.1	一种 SOT23 引线框架及其封装工艺流程	发明	原始申请
6	气派股份	2016-1-15	ZL201610027678.8	高密度集成电路封装结构以及集成电路	发明	原始申请
7	气派股份	2016-6-24	发明第 I628724 号	高密度積體電路封裝結構以及積體電路	发明	原始申请
8	气派股份	2016-7-29	ZL201620819812.3	一种 SMD 包装用载带结构	实用新型	原始申请
9	气派股份	2016-7-29	ZL201620809377.6	一种 SOT 封装的引线框结构	实用新型	原始申请
10	气派股份	2016-9-8	US9768101B2	高密度集成电路封装结构以及集成电路	发明	通过 PCT 途径申请
11	气派股份	2018-4-11	ZL201820507787.4	一种集成电路封装结构	实用新型	原始申请
12	气派股份	2018-6-19	ZL201820946577.5	一种用于 DFN/QFN 封装切割分离的贴膜组件	实用新型	原始申请
13	气派股份	2019-1-22	ZL201920107920.1	一种宽度可调的双面视检装置	实用新型	原始申请
14	气派股份	2018-4-11	ZL201810320806.7	一种集成电路封装结构及其加工方法	发明	原始申请
15	气派股份	2019-6-4	ZL201920838486.4	一种易去除溢料的引线框结构	实用新型	原始申请
16	气派股份	2019-7-24	ZL201921169958.8	一种芯片封装产品	实用新型	原始申请
17	气派股份	2019-7-23	ZL201930392947.5	集成电路封装体（CSOT23-3）	外观设计	原始申请
18	气派股份	2019-7-23	ZL201930392957.9	集成电路封装体(CSOT23-5-6)	外观设计	原始申请
19	气派股份	2019-7-23	ZL201930393120.6	集成电路封装体（CSOT23-8）	外观设计	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
20	气派股份	2019-7-23	ZL2019303929 68.7	集成电路封装体（CSOT89-5）	外观设计	原始申请
21	气派股份	2019-7-23	ZL2019303929 65.3	集成电路封装体（CSOT89-3）	外观设计	原始申请
22	气派股份	2019-7-23	ZL2019303929 61.5	集成电路封装体（CSOT223）	外观设计	原始申请
23	气派股份	2019-7-23	ZL2019303929 69.1	集成电路封装体(CTO220-5-11)	外观设计	原始申请
24	气派股份	2019-7-23	ZL2019303931 33.3	集成电路封装体（CTO252-7-11）	外观设计	原始申请
25	气派股份	2019-7-30	ZL2019212124 70.9	无引脚的两侧基岛外伸散热用的高散热带引脚的封装结构	实用新型	原始申请
26	气派股份	2019-7-30	ZL2019304092 52.3	集成电路封装体（CCPC14-7）	外观设计	原始申请
27	气派股份	2019-8-1	ZL2019212336 81.0	顶部可扩展散热片超高散热封装结构	实用新型	原始申请
28	气派股份	2019-8-2	ZL2019304187 32.6	集成电路封装体（QFL-E1）	外观设计	原始申请
29	气派股份	2019-8-2	ZL2019304184 55.9	集成电路封装体（QFL-E2）	外观设计	原始申请
30	气派股份	2019-9-10	ZL2019215006 22.5	一种产品底部悬空的封装结构	实用新型	原始申请
31	气派股份	2019-9-29	ZL2019305395 00.6	集成电路封装体（CDFN14-7A1）	外观设计	原始申请
32	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 99.7	集成电路封装体（CDFN14-7A2）	外观设计	原始申请
33	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 90.8	集成电路封装体（CDFN14-7A5）	外观设计	原始申请
34	气派股份	2019-9-29	ZL2019305390 03.6	集成电路封装体（CDFN14-7A6）	外观设计	原始申请
35	气派股份	2019-9-29	ZL2019305390 01.7	集成电路封装体（CDFN14-7A7）	外观设计	原始申请
36	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 97.8	集成电路封装体（CDFN14-7A8）	外观设计	原始申请
37	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 98.2	集成电路封装体（CDFN14-7A9）	外观设计	原始申请
38	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 89.5	集成电路封装体（CDFN14-7A10）	外观设计	原始申请
39	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 95.0	集成电路封装体（CQFNH12-H32）	外观设计	原始申请
40	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 96.3	集成电路封装体（CQFNHB11-39）	外观设计	原始申请
41	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 95.9	集成电路封装体（CQFN-HC6）	外观设计	原始申请
42	气派股份	2019-9-29	ZL2019305394 94.4	集成电路封装体（CDFN-H23-3）	外观设计	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
43	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 87.6	集成电路封装体（CDFN- H89-3）	外观设计	原始申请
44	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 86.1	集成电路封装体（CDFN- H89-5）	外观设计	原始申请
45	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 92.7	集成电路封装体（CDFN- H223）	外观设计	原始申请
46	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 80.4	集成电路封装体 （CDFN252-H3）	外观设计	原始申请
47	气派股份	2019-9-29	ZL2019305389 85.7	集成电路封装（CDFN252-5- 5A）	外观设计	原始申请
48	气派股份	2020-1-9	007533146- 0001	集成电路封装体 （CCPC14-7）	外观设计	原始申请
49	气派股份	2020-3-24	328572-001	集成电路封装体（CCPC14- 7A2）	外观设计	原始申请
50	气派股份	2020-3-18	007759758- 0001	集成电路封装体（CCPC14- 7A10）	外观设计	原始申请
51	气派股份	2020-3-18	007754973- 0001	集成电路封装体（CCPC14- 7A7）	外观设计	原始申请
52	气派股份	2020-3-18	007760756- 0001	集成电路封装体（CCPC14- 7A6）	外观设计	原始申请
53	气派股份	2020-3-18	007759311- 0001	集成电路封装体（CCPC14- 7A5）	外观设计	原始申请
54	气派股份	2020-8-28	ZL2020218332 79.9	一种改良的踢料装置的踢料 爪	实用新型	原始申请
55	气派股份	2020-9-29	ZL2020221863 38.4	多功能万用表	实用新型	原始申请
56	气派股份	2019-9-29	ZL2020306241 71.8	集成电路封装（CQFN- HC10-18）	外观设计	原始申请
57	气派股份	2019-9-29	ZL2020306241 57.8	集成电路封装（CQFN- HC22-38）	外观设计	原始申请
58	气派股份	2020-10- 16	ZL2020223183 60.X	一种改善蚀刻应力的引线框 架	实用新型	原始申请
59	气派股份	2020-10- 26	ZL2020224119 75.7	一种改善切割分层的镍钎金 引线框架	实用新型	原始申请
60	气派股份	2020-12- 14	ZL2020229964 43.4	一种显微镜的镜头防水雾结 构	实用新型	原始申请
61	气派股份	2020-12- 21	ZL2020231080 48.4	一种有杆气缸推料装置	实用新型	原始申请
62	气派股份	2021-3-15	ZL2021205331 61.2	紧线器和固定支脚结合结构	实用新型	原始申请
63	气派股份	2021-5-31	ZL2021211982 02.3	一种半自动推料入盒装置	实用新型	原始申请
64	气派股份	2021-6-9	ZL2021212931 31.5	一种引线框架的步进式输送 装置	实用新型	原始申请
65	气派股份	2021-7-22	ZL2021216851 06.1	一种引线框架手动上料架	实用新型	原始申请
66	气派股份	2020-3-17	USD920,266S	集成电路封装 CCPC14-7A1 Integrated circuit package	外观设计	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
67	气派股份	2020-3-17	USD920,265S	集成电路封装 CCPC14-7A9 Integrated circuit package	外观设计	原始申请
68	气派股份	2021-10-29	ZL202111270785.0	一种全自动千级无尘室环保型芯片封装框架料盒清洗机	发明	原始申请
69	气派股份	2021-12-6	ZL202111480235.1	一种高可靠性封装结构的制备方法	发明	原始申请
70	气派股份	2022-7-11	ZL202221789547.0	一种芯片金属焊线弧高的检测设备	实用新型	原始申请
71	气派股份	2022-7-11	ZL202221779959.6	一种新型芯片腐球检验用设备	实用新型	原始申请
72	气派股份	2022-8-16	ZL20222163065.0	一种电镀夹具	实用新型	原始申请
73	气派股份	2022-8-16	ZL20222158723.7	一种可调式感应器安装结构	实用新型	原始申请
74	气派股份	2022-10-27	ZL202222851390.6	一种半导体饱和蒸汽试验用治具	实用新型	原始申请
75	气派股份	2023-2-14	ZL202320270121.2	一种冲切治具	实用新型	原始申请
76	气派股份	2023-5-23	ZL202321277738.3	一种高散热的新型封装结构	实用新型	原始申请
77	气派股份	2023-8-21	ZL202322243904.4	一种解决 TO252 引脚压伤的封装配合机构	实用新型	原始申请
78	气派股份	2023-9-18	ZL202322527557.8	一种高密度引线框架	实用新型	原始申请
79	气派股份	2023-9-21	ZL202311222955.7	一种可兼容多脚、贯穿式注塑的四行 TO263 封装框架	发明	原始申请
80	气派股份	2023-11-7	ZL202323006890.0	一种预防产品注塑脱模拉裂的框架结构	实用新型	原始申请
81	气派股份	2023-11-30	ZL202323271559.1	一种半导体封装设备出料防呆报警系统	实用新型	原始申请
82	气派股份	2023-12-18	ZL202323466534.7	一种盖带导向限位装置	实用新型	原始申请
83	气派股份	2024-1-24	ZL202420181486.2	一种 tray 盘堆叠计数治具	实用新型	原始申请
84	气派股份	2024-1-24	ZL202420178841.0	一种半导体器件测试座	实用新型	原始申请
85	气派股份	2024-1-30	ZL202420228324.X	一种提升散热性能的 DIP 半导体器件	实用新型	原始申请
86	气派股份	2024-3-4	ZL202420418609.X	一种激光镭射压条装置	实用新型	原始申请
87	气派股份	2024-3-26	ZL202420591539.8	一种提高加工精度及防止注塑成型偏移的引线框架结构	实用新型	原始申请
88	气派股份	2024-5-8	ZL202420987038.1	一种引线框架变形检验治具	实用新型	原始申请
89	气派股份	2024-5-24	ZL202421180060.1	一种新型的 DIP 封装结构	实用新型	原始申请
90	气派股份	2024-7-9	ZL202421609468.6	一种高密度 TOLL 引线框架	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
91	气派股份	2025-1-13	ZL2025201332 55.9	一种提高蚀刻产品可靠性的 框架结构	实用新型	原始申请
92	气派股份	2025-1-17	ZL2025201209 31.9	一种提高材料利用和设备效率 的引线框架结构	实用新型	原始申请
93	气派股份	2025-5-7	ZL2025105811 67.X	一种引线框架结构及封装方 法	发明	原始申请
94	气派股份	2025-7-29	ZL2025110443 83.7	一种高密度框架结构及其制 作方法	发明	原始申请
95	广东气派	2016-7-29	ZL2016208151 22.0	一种 CPC 封装引线框结构	实用新型	原始申请
96	广东气派	2016-7-29	ZL2016208160 08.X	一种六引脚的 CPC8 封装引 线框结构	实用新型	原始申请
97	广东气派	2016-7-29	ZL2016208294 05.0	一种四引脚的集成电路封装 结构	实用新型	原始申请
98	广东气派	2016-7-29	ZL2016208285 94.X	一种二十、二十四引脚的 CPC 封装引线框结构	实用新型	原始申请
99	广东气派	2016-7-29	ZL2016208285 82.7	一种十二、十四引脚的 CPC 封装引线框结构	实用新型	原始申请
100	广东气派	2017-8-1	ZL2017209514 24.5	一种集成电路封装结构	实用新型	原始申请
101	广东气派	2018-4-4	ZL2018204847 17.1	一种夹式上料装置	实用新型	原始申请
102	广东气 派、昂宝 电子	2018-8-7	ZL2018212650 65.9	集成电路的封装结构	实用新型	原始申请
103	广东气派	2018-7-11	ZL2018210946 08.5	集成电路封装中基岛悬空的 引线框结构	实用新型	原始申请
104	广东气派	2018-11- 26	ZL2018219564 81.3	一种高精度多功能螺纹涂胶 机构	实用新型	原始申请
105	广东气派	2018-12- 11	ZL2018220745 24.1	一种铜夹堆叠芯片结构	实用新型	原始申请
106	广东气派	2019-1-22	ZL2019100582 33.X	解决 SMD 元器件过波峰焊 连锡的方法和 SMD 元器件	发明	原始申请
107	广东气派	2019-1-24	ZL2019201296 60.8	一种集成被动元件的芯片封 装结构	实用新型	原始申请
108	广东气派	2019-6-4	ZL2019208380 16.8	封装产品印字位置快速检测 装置	实用新型	原始申请
109	广东气派	2019-6-4	ZL2019208381 01.4	一种芯片封装产品	实用新型	原始申请
110	广东气派	2019-6-4	ZL2019104836 72.5	一种封装模块天线的封装方 法及封装结构	发明	原始申请
111	广东气派	2019-6-4	ZL2019208324 49.2	一种封装模块天线的封装结 构	实用新型	原始申请
112	广东气派	2019-6-4	ZL2019208380 65.1	一种高密度无基岛芯片封装 结构	实用新型	原始申请
113	广东气派	2019-7-10	ZL2019210736 33.X	一种芯片封装用的铜夹和芯 片封装结构	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
114	广东气派	2019-7-10	ZL2019210736 09.6	一种改善焊接空洞的芯片封装结构	实用新型	原始申请
115	广东气派	2019-7-19	ZL2019106564 93.7	高密度多侧面引脚外露的封装结构及其生产方法	发明	原始申请
116	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 56.4	集成电路封装件（CCPC8-4）	外观设计	原始申请
117	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 84.6	集成电路封装体（CCPC2-10）	外观设计	原始申请
118	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 60.0	集成电路封装体(CCPC4A-6A)	外观设计	原始申请
119	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 85.0	集成电路封装体(CCPC5A)	外观设计	原始申请
120	广东气派	2019-7-23	ZL2019303930 10.X	集成电路封装体（CCPC7-7A）	外观设计	原始申请
121	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 82.7	集成电路封装体（CCPC7B）	外观设计	原始申请
122	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 81.2	集成电路封装体（CCPC7C）	外观设计	原始申请
123	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 87.X	集成电路封装体(CCPC8)	外观设计	原始申请
124	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 85.0	集成电路封装体（CCPC8-5）	外观设计	原始申请
125	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 88.4	集成电路封装体(CCPC8-6)	外观设计	原始申请
126	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 73.8	集成电路封装体(CCPC12-32)	外观设计	原始申请
127	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 98.8	集成电路封装体（CCPC14-5-6）	外观设计	原始申请
128	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 90.1	集成电路封装体（CSOP2-4）	外观设计	原始申请
129	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 96.9	集成电路封装体（CSOP6）	外观设计	原始申请
130	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 59.8	集成电路封装体（CSOP7-7A）	外观设计	原始申请
131	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 58.3	集成电路封装体（CSOP8-12）	外观设计	原始申请
132	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 89.9	集成电路封装体（CSOP8A）	外观设计	原始申请
133	广东气派	2019-7-23	ZL2019303929 37.1	集成电路封装体(CSOP8B-D)	外观设计	原始申请
134	广东气派	2019-7-23	ZL2019303931 88.4	集成电路封装体（CSOP8C）	外观设计	原始申请
135	广东气派	2019-7-23	ZL2019303930 06.3	集成电路封装体（CSOP14-16）	外观设计	原始申请
136	广东气派	2019-7-23	ZL2019303930 02.5	集成电路封装体（CSOP20-32）	外观设计	原始申请
137	广东气派	2019-7-26	ZL2019106798 31.9	非接触式上下芯片封装结构及其封装方法	发明	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
138	广东气派	2019-7-26	ZL2019211897 93.0	非接触式上下芯片封装结构	实用新型	原始申请
139	广东气派	2019-8-1	ZL2019212311 73.9	三边外伸大散热片高散热性 封装结构	实用新型	原始申请
140	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 83.0	集成电路封装体（QFL32- 80）	外观设计	原始申请
141	广东气派	2019-8-2	ZL2019304187 56.1	集成电路封装体（QFL8- 28）	外观设计	原始申请
142	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 77.5	集成电路封装体（QFL-E9）	外观设计	原始申请
143	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 69.0	集成电路封装体（QFL-E8）	外观设计	原始申请
144	广东气派	2019-8-2	ZL2019304187 44.9	集成电路封装体（QFL-E7）	外观设计	原始申请
145	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 68.6	集成电路封装体（QFL-E6）	外观设计	原始申请
146	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 63.3	集成电路封装体（QFL-E5）	外观设计	原始申请
147	广东气派	2019-8-2	ZL2019304184 62.9	集成电路封装体（QFL-E4）	外观设计	原始申请
148	广东气派	2019-8-2	ZL2019304187 41.5	集成电路封装体（QFL-E3）	外观设计	原始申请
149	广东气派	2019-9-29	ZL2019305394 87.4	集成电路封装体（CDFN- H5A-H8）	外观设计	原始申请
150	广东气派	2019-9-29	ZL2019305394 86.X	集成电路封装体（CDFN- H7-H7A）	外观设计	原始申请
151	广东气派	2019-9-29	ZL2019305394 84.0	集成电路封装体（CSOP-H8- H16）	外观设计	原始申请
152	广东气派	2019-10- 24	ZL2019218066 46.3	一种引线框双面焊接组装的 封装结构	实用新型	原始申请
153	广东气派	2019-10- 24	ZL2019218008 62.7	一种小尺寸异形元件的堆叠 封装结构	实用新型	原始申请
154	广东气派	2019-11- 19	ZL2019111361 61.2	解决 5G GaN 芯片焊接高可 靠性要求的封装焊接结构	发明	原始申请
155	广东气派	2019-11- 19	ZL2019220096 25.5	解决 5G GaN 芯片焊接高可 靠性要求的封装焊接结构	实用新型	原始申请
156	广东气派	2019-12- 27	ZL2019224007 65.5	一种保证大功耗 GAN 芯片 导热层厚度的点胶治具	实用新型	原始申请
157	广东气派	2019-12- 27	ZL2019224263 75.5	一种用于 5G 封装产品塑封 后产品抗翘曲的烘烤治具	实用新型	原始申请
158	广东气派	2019-12- 30	ZL2019224837 42.5	一种改善封装产品塑封体拉 裂的新型模具结构	实用新型	原始申请
159	广东气派	2019-12- 27	ZL2019224268 08.7	一种防止引脚上引线焊点断 裂的引线框结构	实用新型	原始申请
160	广东气派	2019-12- 27	ZL2019223974 04.X	一种检测 5G GaN 射频芯片 胶层空洞的快速定位治具	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
161	广东气派	2020-1-9	202017051349 (注册号 463075)	高密度多侧面引脚外露的封装结构及其生产方法	发明	原始申请
162	广东气派	2020-1-19	007531603- 0001	集成电路封装体 (QFL32-80)	外观设计	原始取得
163	广东气派	2020-1-21	US D934,187 S	集成电路封装体 (QFL8-28)	外观设计	原始取得
164	广东气派	2020-5-22	ZL2020208835 08.1	一种高可靠性的引线框架结构	实用新型	原始申请
165	广东气派	2020-7-9	ZL2020213431 22.8	自动清模装置	实用新型	原始申请
166	广东气派	2020-7-10	ZL2020213588 85.X	防卡料键合机	实用新型	原始申请
167	广东气派	2020-7-20	ZL2020214346 67.X	一种塔式上料导轨结构	实用新型	原始申请
168	广东气派	2020-8-18	ZL2020108299 70.8	一种 DFN 或 QFN 引线框架及其制造方法	发明	原始申请
169	广东气派	2020-8-18	ZL2020217291 85.7	一种 DFN 或 QFN 引线框架	实用新型	原始申请
170	广东气派	2020-8-28	ZL2020218332 98.1	一种解决 DIP 系列产品暗裂分层的冲切模具	实用新型	原始申请
171	广东气派	2020-9-22	ZL2020220943 63.X	一种大功率高散热封装引线框架及封装结构	实用新型	原始申请
172	广东气派	2020-9-22	ZL2020220943 42.8	一种提升 QFN 封装产品真空吸附能力的压焊夹具	实用新型	原始申请
173	广东气派	2020-11-18	ZL2020226676 57.7	一种具有消除静电和清洁功能的装片辅助装置	实用新型	原始申请
174	广东气派	2020-12-16	ZL2020230447 79.7	一种提高良率的冲胶模具	实用新型	原始申请
175	广东气派	2020-12-18	ZL2020230863 29.4	一种载带切刀的快速切换装置	实用新型	原始申请
176	广东气派	2020-12-28	ZL2020232169 35.3	一种半自动排片推送料装置	实用新型	原始申请
177	广东气派	2021-1-4	ZL2021200207 35.6	一种适用于有贴膜的 DFN/QFN 引线框架的固定夹具	实用新型	原始申请
178	广东气派	2021-1-27	ZL2021202346 04.8	一种提高芯片导电导热和粘接性能的封装结构	实用新型	原始申请
179	广东气派	2021-1-27	ZL2021202346 01.4	一种嵌入式芯片封装结构	实用新型	原始申请
180	广东气派	2021-1-27	ZL2021202345 34.6	一种隐藏装片胶胶厚的芯片封装结构	实用新型	原始申请
181	广东气派	2021-1-28	ZL2021202414 21.9	一种改善高脚位 QFN/DFN 产品键合异常的引线框架	实用新型	原始申请
182	广东气派	2021-4-7	ZL2021207118 42.3	一种利于上锡排气的芯片封装管脚结构	实用新型	原始申请
183	广东气派	2021-5-12	ZL2021210067 17.9	一种半导体手动测试验证装置	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
184	广东气派	2021-6-10	ZL2021106486 93.5	通信用高频功放芯片的封装 结构及其封装方法	发明	原始申请
185	广东气派	2021-6-10	ZL2021213003 01.8	高频功放芯片封装的散热结 构	实用新型	原始申请
186	广东气派	2021-7-22	ZL2021216805 41.5	一种防止溢胶的半导体塑封 模具	实用新型	原始申请
187	广东气派	2021-8-12	ZL2021218889 88.1	一种引线框架的装片垫块及 具有其的半导体封装设备	实用新型	原始申请
188	广东气派	2020-1-9	US11088053B 2	高密度多侧面引脚外露的封 装结构及其生产方法	发明	原始申请
189	广东气派	2021-9-7	ZL2021110440 09.9	一种提升 SOP 型封装产品生 产效率的生产方法	发明	原始申请
190	广东气派	2021-9-7	ZL2021221477 78.3	一种提升 SOP 型封装产品生 产效率的塑封模具	实用新型	原始申请
191	广东气派	2021-10- 14	ZL2021111994 66.5	exposed lead 从顶部引出的 QFN/LGA 的封装结构及其 制造方法	发明	原始申请
192	广东气派	2021-10- 18	ZL2021112106 16.8	高稳定性的 MEMS 封装产品 及其制造方法	发明	原始申请
193	广东气派	2021-10- 20	ZL2021225307 16.0	一种新型的封装芯片分层超 声波扫描夹具	实用新型	原始申请
194	广东气派	2021-11- 12	ZL2021228061 03.5	一种物料衔接传送平台	实用新型	原始申请
195	广东气派	2021-11- 12	ZL2021227668 07.4	一种外放式鼠标座	实用新型	原始申请
196	广东气派	2021-11- 24	ZL2021114065 44.4	一种引线框架连筋结构	发明	原始申请
197	广东气派	2021-11- 24	ZL2021114027 29.8	一种控制半导体封装过程中 粘接剂稳定性的工艺方法	发明	原始申请
198	广东气派	2021-12- 21	ZL2021115709 96.6	一种改善 Flip chip bump 桥 接的制造方法	发明	原始申请
199	广东气派	2022-1-5	ZL2022100052 70.6	一种改善 Flip chip 基板翘 曲,bump 桥接和 Die crack 的 治具	发明	原始申请
200	广东气派	2022-1-7	ZL2022100121 17.6	一种改善 Flip chip 晶圆电路 层裂纹的方法	发明	原始申请
201	广东气派	2022-1-7	ZL2022100121 16.1	一种阻止底部填充胶溢胶的 基板设计方法	发明	原始申请
202	广东气派	2022-1-10	ZL2022100191 31.9	一种 GaN 产品上 ESD 现场 管控方法	发明	原始申请
203	广东气派	2022-1-12	ZL2022200661 34.3	一种可以高效率补料的托盘 治具	实用新型	原始申请
204	广东气派	2022-1-17	ZL2022100460 77.7	一种 4 位和 8 位测试座相互 兼容装置	发明	原始申请
205	广东气派	2022-1-17	ZL2022100461 05.5	一种适用于重力式分选机的 压测装置	发明	原始申请
206	广东气派	2022-1-18	ZL2022100533 79.7	一种自动清除料盘残留设备 及清除方法	发明	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
207	广东气派	2022-1-18	ZL202210053384.8	一种多基岛大功率模组 QFN 的封装结构	发明	原始申请
208	广东气派	2022-1-21	ZL202210070385.3	一种高速编带自动拆带机及拆带方法	发明	原始申请
209	广东气派	2022-2-17	ZL202220328167.0	一种震动式自动筛废渣装置	实用新型	原始申请
210	广东气派	2022-2-17	ZL202220327005.5	一种用于收纳料管的新型料筒	实用新型	原始申请
211	广东气派	2022-3-22	ZL202220628637.5	一种自动检查测试座开尔文装置	实用新型	原始申请
212	广东气派	2022-3-25	ZL202220662089.8	一种用于无尘车间的滚动式物料传递结构	实用新型	原始申请
213	广东气派	2022-3-25	ZL202220673755.8	一种配料自动提示装置	实用新型	原始申请
214	广东气派	2022-3-28	ZL202220690217.X	一种 PIN 底座	实用新型	原始申请
215	广东气派	2022-3-28	ZL202220690218.4	一种具有防护装置的 DUT-BOARD 装置	实用新型	原始申请
216	广东气派	2022-4-2	ZL202220752381.9	一种改善铜夹回流偏移的封装结构	实用新型	原始申请
217	广东气派	2022-4-7	ZL202220790997.5	一种芯片产品腐球检验用自动化防超时设备	实用新型	原始申请
218	广东气派	2022-4-14	ZL202210386544.0	一种电流传感器及其封装工艺	发明	原始申请
219	广东气派	2022-4-22	ZL202210423918.1	改善双面散热器件应力问题的集成电路封装及制造方法	发明	原始申请
220	广东气派	2022-5-7	ZL202210488727.3	一种具有电磁屏蔽功能的芯片封装结构及封装方法	发明	原始申请
221	广东气派、东莞职业技术学院	2022-5-10	ZL202221116542.1	一种芯片键合机的废丝回收装置	实用新型	原始申请
222	广东气派、东莞职业技术学院	2022-5-10	ZL202221116325.2	一种 QFN 封装半导体溢胶打磨防划伤治具	实用新型	原始申请
223	广东气派	2022-5-12	ZL202210511181.9	一种防超时的芯片产品腐球检验工艺	发明	原始申请
224	广东气派、东莞职业技术学院	2022-6-23	ZL202221587686.5	一种物料醒料回温定时控制设备	实用新型	原始申请
225	广东气派	2022-7-6	ZL202221733006.6	一种自动更换盖带装置	实用新型	原始申请
226	广东气派	2022-7-8	ZL202221750267.9	一种筛选产品碎料送料装置	实用新型	原始申请
227	广东气派	2022-7-13	ZL202221794588.9	一种编带返工压合机	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
228	广东气派	2022-7-20	ZL2022218858 43.0	一种具有侧翼散热结构的 CDFN8-7 封装体	实用新型	原始申请
229	广东气派	2022-7-21	ZL2022218883 09.5	一种电路板的新型跳线结构	实用新型	原始申请
230	广东气派	2022-8-23	ZL202222130 67.6	一种平移式上料抓手装置	实用新型	原始申请
231	广东气派	2022-8-24	ZL202222387 37.X	一种测试板卡搭源验证板	实用新型	原始申请
232	广东气派	2022-8-30	ZL202222983 83.8	多基岛 QFN 封装结构	实用新型	原始申请
233	广东气派	2022-9-8	ZL2022110920 58.4	高密度脚插脚 TO247 封装引 线框架及其制作方法	发明	原始申请
234	广东气派	2022-9-9	ZL202224106 75.6	一种引线框架及集成电路	实用新型	原始申请
235	广东气派	2022-10- 10	ZL2022112307 32.0	QFN 冲压框架、冲压模具及 制备方法	发明	原始申请
236	广东气派	2022-10- 22	ZL2022228083 14.7	引线框架封装结构	实用新型	原始申请
237	广东气派	2022-10- 24	ZL2022228030 46.X	一种 T 型台激光打印机防反 装置	实用新型	原始申请
238	广东气派	2022-10- 25	ZL2022228380 61.8	芯片封装结构	实用新型	原始申请
239	广东气派	2022-10- 25	ZL2022228138 97.2	一种 ASM 键合设备的挡板 自动调节装置	实用新型	原始申请
240	广东气派	2022-10- 25	ZL2022228119 37.X	一种快速定位贴膜工具	实用新型	原始申请
241	广东气派	2022-11-4	ZL2022229379 83.4	一种新型切割取边工具	实用新型	原始申请
242	广东气派	2022-11- 10	ZL2022229955 05.9	一种内绝缘的双面散热封装 结构	实用新型	原始申请
243	广东气派	2022-11- 24	ZL2022114782 58.3	高密度头对头 TO247 封装引 线框架及其封装方法	发明	原始申请
244	广东气派	2023-1-10	ZL2023200664 98.6	一种功率器件框架新型扣胶 结构	实用新型	原始申请
245	广东气派	2023-1-10	ZL2023200746 11.5	一种小尺寸无引线封装结构	实用新型	原始申请
246	广东气派 科技有限 公司、东 莞职业技 术学院	2023-2-1	ZL2023201424 57.0	一种切筋刀具	实用新型	原始申请
247	广东气派	2023-2-16	ZL2023202253 61.0	一种缓冲式新型取产品、刀 具工具	实用新型	原始申请
248	广东气派	2023-2-22	ZL2023202782 26.2	一种适用于 MSOP8 的测试 压盖	实用新型	原始申请
249	广东气派	2023-2-22	ZL2023101458 17.7	改善大功率 GaN 芯片塑料封 装热应力的封装结构及方法	发明	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
250	广东气派	2023-3-6	ZL2023101998 77.7	一种大功率射频器件增强散热的封装结构及制备方法	发明	原始申请
251	广东气派	2023-5-8	ZL2023105074 10.4	一种 GaN 芯片的封装结构	发明	原始申请
252	广东气派	2023-5-10	ZL2023211246 26.4	IC 控制氮化镓 MOS 的堆叠结构	实用新型	原始申请
253	广东气派	2023-5-16	ZL2023211894 66.1	一种金属夹堆叠芯片封装结构	实用新型	原始申请
254	广东气派	2023-5-23	ZL2023105808 45.1	一种大功率器件的封装结构和方法	发明	原始申请
255	广东气派	2023-6-7	ZL2023214438 80.0	一种框架封装结构	实用新型	原始申请
256	广东气派	2023-6-15	ZL2023107054 41.0	双面打线的键合、倒装组合堆叠芯片结构及制备方法	发明	原始申请
257	广东气派	2023-6-16	ZL2023107183 02.1	一种增强散热的盖板封装结构制备方法及盖板封装结构	发明	原始申请
258	广东气派	2023-6-21	ZL2023215894 11.X	一种 IC 芯片驱动多颗 MOS 芯片的合封 IPM 封装结构	实用新型	原始申请
259	广东气派	2023-6-27	ZL2023216406 52.2	一种针对 SOT89 产品的高耐压封装	实用新型	原始申请
260	广东气派	2023-9-15	ZL2023225248 78.2	一种防止管脚分层的封装结构	实用新型	原始申请
261	广东气派	2023-9-20	ZL2023112107 69.1	高密度大矩阵 SOT89 封装结构的制备方法	发明	原始申请
262	广东气派	2023-10-9	ZL2023226987 41.9	一种 MEMS 封装结构	实用新型	原始申请
263	广东气派	2023-10-24	ZL2023228528 14.5	一种 MEMS 麦克风基板的封装治具	实用新型	原始申请
264	广东气派	2023-10-26	ZL2023228792 08.2	一种基于 IDF 的 SOT23-X 引线框架	实用新型	原始申请
265	广东气派	2023-10-26	ZL2023228793 65.3	一种 MEMS 麦克风的封装工具	实用新型	原始申请
266	广东气派	2023-11-7	ZL2023230088 04.X	一种带散热片的预制模引线框架	实用新型	原始申请
267	广东气派	2023-11-7	ZL2023230100 14.5	一种小尺寸 DFN 封装结构	实用新型	原始申请
268	广东气派	2023-11-10	ZL2023230368 71.2	一种高压隔离封装结构	实用新型	原始申请
269	广东气派	2023-11-21	ZL2023231315 25.2	一种测试站下压限位装置	实用新型	原始申请
270	广东气派	2023-11-21	ZL2023231322 58.0	一种载带压痕防呆装置	实用新型	原始申请
271	广东气派	2023-11-30	ZL2023232660 92.1	一种离子风枪固定支架	实用新型	原始申请
272	广东气派	2023-12-1	ZL2023232661 34.1	一种 MEMS 基板的压合治具	实用新型	原始申请
273	广东气派	2023-12-18	ZL2023234629 68.X	一种全自动等离子清洗机防卡料检测装置	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
274	广东气派	2023-12-19	ZL2023234789 75.9	装片机防叠料检测装置	实用新型	原始申请
275	广东气派	2023-12-21	ZL2023234986 38.6	一种多用途 IC 料管支架	实用新型	原始申请
276	广东气派	2023-12-21	ZL2023234991 42.0	一种可伸缩立式夹板	实用新型	原始申请
277	广东气派	2023-12-22	ZL2023235073 54.9	一种无尘室物料车的脚轮清洗设备	实用新型	原始申请
278	广东气派	2023-12-22	ZL2023235081 82.7	一种无尘室的料盒自动清洗设备	实用新型	原始申请
279	广东气派	2023-12-22	ZL2023235357 29.2	一种 UV 膜刮料工具	实用新型	原始申请
280	广东气派	2023-12-26	ZL2023235578 53.9	一种多用途半导体料盘高度的测量治具	实用新型	原始申请
281	广东气派	2023-12-28	ZL2023236079 64.6	一种防止半导体料盘翻盘的捆绑治具	实用新型	原始申请
282	广东气派	2023-12-28	ZL2023236231 40.8	一种降低装片机台挤胶量带固定装置的点胶杆装置	实用新型	原始申请
283	广东气派	2023-12-29	ZL2023236242 64.8	一种晶圆贴膜设备	实用新型	原始申请
284	广东气派	2023-12-29	ZL2023236706 16.3	一种镭射机保护液凝固可快速溶解的装置	实用新型	原始申请
285	广东气派	2024-1-8	ZL2024200496 39.8	一种引线框架压合夹具	实用新型	原始申请
286	广东气派、东莞职业技术学院	2024-1-8	ZL2024200490 63.5	一种键合设备防引线框架下凹支撑结构	实用新型	原始申请
287	广东气派	2024-1-23	ZL2024201596 45.9	一种全自动贴膜机用的定位结构	实用新型	原始申请
288	广东气派	2024-3-8	ZL2024102629 36.5	低热阻的双面金属散热 TO247 结构及制备方法	发明	原始申请
289	广东气派	2024-3-18	ZL2024205194 69.5	贴膜机用的拉膜送料装置	实用新型	原始申请
290	广东气派	2024-3-22	ZL2024205756 80.9	一种检测键合线弧的治具	实用新型	原始申请
291	广东气派	2024-3-22	ZL2024205758 58.X	一种预防人为造成塌丝的抽检治具	实用新型	原始申请
292	广东气派	2024-4-1	ZL2024206496 77.7	一种 MOSFET 的 TOLT 封装结构	实用新型	原始申请
293	广东气派	2024-4-2	ZL2024206640 70.6	一种具有三种行间距的 SOT89 引线框架	实用新型	原始申请
294	广东气派	2024-4-17	ZL2024104578 69.2	六行 TO263 框架及其加工方法	发明	原始申请
295	广东气派	2024-5-23	ZL2024211489 95.1	一种双面散热封装结构	实用新型	原始申请
296	广东气派	2024-5-23	ZL2024211490 04.1	适合双面散热的 TO247 封装结构	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
297	广东气派	2024-7-2	ZL2024215543 30.0	一种胶量易于管控的点胶头	实用新型	原始申请
298	广东气派	2024-8-1	ZL2024218560 99.0	防止塑封分层的 SOT89 框架 结构	实用新型	原始申请
299	广东气派	2024-8-22	ZL2024220488 48.3	一种料盒出料阻挡结构	实用新型	原始申请
300	广东气 派、东莞 职业技术 学院	2024-8-26	ZL2024220704 27.0	一种高效散热的封装结构	实用新型	原始申请
301	广东气派	2024-9-3	ZL2024112262 50.7	自适应的双面散热封装结构 和制造方法	发明	原始申请
302	广东气派	2024-9-24	ZL2024223268 71.4	一种 MEMS 编带设备清洁装 置	实用新型	原始申请
303	广东气派	2024-9-24	ZL2024223276 63.6	一种 MEMS 产品测试设备的 半开放式震动直轨治具	实用新型	原始申请
304	广东气派	2024-9-24	ZL2024223281 21.0	一种料盒清洗机吹风装置	实用新型	原始申请
305	广东气 派、东莞 职业技术 学院	2024-9-24	ZL2024223428 69.6	装片机焊头装置	实用新型	原始申请
306	广东气派	2024-9-26	ZL2024223660 88.0	一种防溢胶、增强散热的封 装结构	实用新型	原始申请
307	广东气 派、东莞 职业技术 学院	2024-9-26	ZL2024223473 66.8	Si 基 SiC-Si 外延片结构	实用新型	原始申请
308	广东气 派、东莞 职业技术 学院	2024-10- 17	ZL2024225136 64.X	一种 DFN 封装大功率射频 器件	实用新型	原始申请
309	广东气 派、东莞 职业技术 学院	2024-10- 17	ZL2024225139 10.1	一种隐藏散热片的 DFN/QFN 封装装置	实用新型	原始申请
310	广东气派	2024-10- 19	ZL2024225353 84.9	一种 IC 引脚导通性测试电 路及测试仪	实用新型	原始申请
311	广东气派	2024-12- 13	ZL2024230814 12.0	一种半导体 IC 引脚导通性 分析仪	实用新型	原始申请
312	广东气派	2024-12- 13	ZL2024230815 99.4	一种包含尾数标记的载带	实用新型	原始申请
313	广东气派	2024-12- 13	ZL2024230817 70.1	一种便携式开尔文测试接触 检测器及测试仪	实用新型	原始申请
314	广东气派	2024-12- 13	ZL2024230820 12.1	一种开尔文测试接触检测器 及测试仪	实用新型	原始申请
315	广东气派	2024-12- 27	ZL2024232631 11.X	一种射频线缆的防护装置	实用新型	原始申请

序号	申请人/ 专利权人	专利申请 日	专利号	名称	类型	取得方式
316	广东气派	2025-1-3	ZL2025200163 87.3	一种半导体测试转塔机分离 吸座结构	实用 新型	原始申请
317	广东气派	2025-1-3	ZL2025200165 24.3	一种半导体上芯设备引线框 架定位载具	实用 新型	原始申请
318	广东气派	2025-1-3	ZL2025200197 49.4	一种键合劈刀清洗治具	实用 新型	原始申请
319	广东气派	2025-1-6	ZL2025200295 54.8	一种拉力测试机固定夹	实用 新型	原始申请
320	广东气派	2025-1-17	ZL2025100820 50.7	一种适用于 MEMS 器件的贴 膜设备	发明	原始申请
321	广东气派	2025-3-19	ZL2025204831 31.3	一种半导体封装结构	实用 新型	原始申请
322	广东气派	2025-3-24	ZL2025205190 17.1	一种 TO247 封装结构	实用 新型	原始申请